

Infinion Technologies Kurzbericht 2005

Impulse geben



Never stop thinking

Infinion-Kennzahlen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre¹

Geschäftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September	2004		2005		2005-2004 Veränderung in %
	Mio. €	in % vom Umsatz	Mio. €	in % vom Umsatz	
Umsatzerlöse	7.195		6.759		-6
nach Regionen					
Deutschland	1.675	23	1.354	20	-19
Übriges Europa	1.263	18	1.210	18	-4
Nordamerika	1.524	21	1.504	22	-1
Asien-Pazifik	2.263	32	2.223	33	-2
Japan	364	5	332	5	-9
Andere	106	1	136	2	28
nach Segmenten					
Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket	2.540	35	2.516	37	-1
Kommunikation	1.689	24	1.391	21	-18
Speicherprodukte	2.926	41	2.826	42	-3
Sonstige Geschäftsbereiche	11	-	12	-	9
Konzernfunktionen	29	-	14	-	-52
Bruttoergebnis vom Umsatz	2.525	35	1.850	27	-27
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.219	17	1.293	19	6
Betriebsergebnis	314		-268		-
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	61		-312		-
Ebit Ebit-Marge	256	4	-183	-3	-
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag pro Aktie – unverwässert und verwässert in €	0,08		-0,42		-
Dividende pro Aktie in €	-		-		-
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.857		1.039		-44
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.809		-238		87
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-402		-266		34
Free-Cash-Flow ²	206		-281		-
Planmäßige Abschreibungen	1.320		1.316		-
Außerplanmäßige Abschreibungen	136		134		-1
Auszahlungen für Sachanlagen	1.163		1.368		18
Brutto-Cash-Position ³	2.546		2.006		-21
Netto-Cash-Position ⁴	548		341		-38
Sachanlagen	3.587		3.751		5
Bilanzsumme	10.864		10.284		-5
Summe Eigenkapital	5.978		5.629		-6
Eigenkapitalquote	55 %		55 %		-
Eigenkapitalrendite ⁵	1 %		-5 %		-
Gesamtkapitalrendite ⁶	1 %		-3 %		-
Anlagendeckung ⁷	167 %		150 %		-10
Verschuldungsgrad ⁸	33 %		30 %		-9
Gesamtverschuldungsgrad	18 %		16 %		-11
Mitarbeiter	35.570		36.440		2

1 Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

2 Free-Cash-Flow = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit minus Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit, verändert um Kauf/Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens.

3 Brutto-Cash-Position = Zahlungsmittel zuzüglich Wertpapiere des Umlaufvermögens.

4 Netto-Cash-Position = Brutto-Cash-Position, verringert um kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten.

5 Eigenkapitalrendite = Jahresüberschuss/fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Eigenkapital.

6 Gesamtkapitalrendite = Jahresüberschuss/fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital.

7 Anlagendeckung = Eigenkapital im Verhältnis zu Sachanlagen.

8 Verschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital.



Titelbild

In Zukunft können nicht nur Stimme und Daten, sondern ganze Spielfilme und Sportveranstaltungen gleichzeitig über die Telefonleitung übertragen werden. Dies ermöglicht die neueste Breitbandtechnologie VDSL2. In diesem Markt sind wir mit unserem VINAX führend.

Akzente setzen.

2005 haben wir Infineon konsequent vorangebracht – Strukturen optimiert, Eigenverantwortung gefördert, Kundenorientierung gestärkt und unsere Effizienz erhöht.

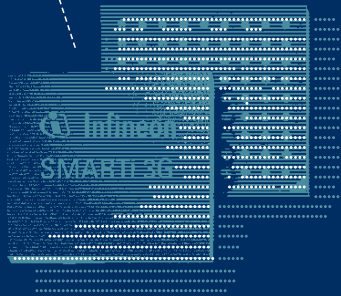
Impulse geben.

2006 richten wir Infineon neu aus, um in Zukunft Wachstumschancen besser zu nutzen. Mit zwei eigenständigen Unternehmen gewinnen wir Wettbewerbsvorteile: für neue Potenziale und einen zielgerichteten Weg hin zu konstantem profitablen Wachstum.

2	Informationen für Aktionäre	16	Kommunikation
4	Brief an die Aktionäre	18	Speicherprodukte
9	Der Vorstand der Infineon Technologies AG	20	Auszug Finanzbericht
10	Die Infineon-Aktie	22	Auszug Konzernlagebericht
12	Unser Unternehmen	38	Konzernfinanzdaten
14	Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket	44	Weitere Informationen

SMARTi 3G

Unsere Hochfrequenz-Transceiver finden Sie bei fast allen großen Handy-Herstellern. Auf unser neuestes Produkt für 3G-Mobiltelefone, den SMARTi 3G, sollte dies genauso zutreffen. Aber er kann noch mehr: Als bisher einziger Transceiver kann der SMARTi 3G in allen UMTS-Mobilfunknetzen dieser Welt eingesetzt werden – gleich, ob bei Ihnen zu Hause, am Hochufer des Huangpu oder am Fuße des Popocatepetl.



Informationen für Aktionäre



Brief an die Aktionäre

Dr. Wolfgang Ziebart
Vorsitzender des Vorstands der Infineon Technologies AG



Sehr geehrte Damen und Herren,

das Geschäftsjahr 2005 war für Infineon ein bewegtes Jahr, in dem wir vieles angepackt und erfolgreich umgesetzt haben. Wir haben große Fortschritte gemacht. So ist es uns gelungen, Infineon durch umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen, signifikante Kosteneinsparung und durch organisatorische Neuaufstellung noch näher am Markt zu orientieren. Allerdings hatten wir auch mit Problemen zu kämpfen: mit einem sehr starken Preisverfall bei Speicher- und Chipkartenprodukten sowie mit massiven Umsatzeinbußen bei einem unserer Schlüsselkunden im Bereich Mobilfunk. Infolge dieser negativen Effekte spiegelt unser Ergebnis unsere Fortschritte nicht wider: Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern belief sich auf – 183 Millionen Euro nach einem Überschuss von 256 Millionen Euro im Vorjahr. Darin enthalten sind allerdings Sonderaufwendungen von netto 104 Millionen Euro vor Steuern.

Auch wenn die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs den Blick dafür verstellen mögen, möchte ich Ihr Augenmerk auf die konsistente Entwicklung lenken, die wir im Vorstand als Ziel verfolgen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir einen deutlichen Richtungswechsel vorgenommen. In der Vergangenheit hat Infineon eine primär auf Wachstum ausgerichtete Strategie verfolgt und damit beachtliche Marktanteile gewonnen. Wir haben damit eine kritische Größe und eine gute Marktposition erreicht und somit die Basis für die Zukunft geschaffen. Veränderungen in allen Bereichen der Halbleiterindustrie erfordern jedoch nun die Konzentration auf profitables Wachstum. Ich möchte Ihnen die Schritte darlegen, die wir im abgelaufenen Jahr auf diesem Weg bereits gegangen sind, und Ihnen anschließend die Maßnahmen erläutern, die wir künftig durchführen werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir einige grundlegende organisatorische Veränderungen vorgenommen. Von größter Bedeutung war die Neuorganisation unseres

Unternehmens, die Anfang 2005 umgesetzt wurde. Mit der Schaffung von Einheiten, die heute erheblich mehr Eigenverantwortung und Handlungsfreiheit aufweisen, haben wir unternehmerische Entscheidungen tiefer in das Unternehmen hinein verlagert als bisher. Wir agieren damit nicht nur flexibler, sondern verkürzen auch unsere Entscheidungswege deutlich und erhöhen unsere Effizienz. Jedes operative Segment wird heute durch einen Vorstand verantwortet. Zusätzlich haben wir unsere zentrale Forschungsabteilung in die einzelnen Segmente eingegliedert, um die von der Forschung ausgehenden Innovationen schneller in neue Produkte umzusetzen.

Ebenfalls im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unverzüglich diejenigen Themen angepackt, bei denen es für uns offensichtlichen Handlungsbedarf gab. Die neue, verstärkt divisionale Struktur hat uns dies erleichtert. Wir haben ein Programm auf den Weg gebracht, mit dem wir 320 Millionen Euro niedrigere Kosten als ursprünglich geplant verzeichneten. Aktivitäten, die nicht zu unserem Kerngeschäft gehören, haben wir beendet oder veräußert. Darunter fallen beispielsweise der Verkauf von Infineon Ventures und die Bereinigung des Emerging-Business-Portfolios, zu dem unter anderem der Bereich Wearable Electronics und die Biochip-Aktivitäten gehörten. Innerhalb unseres Kerngeschäfts haben wir dann die Geschäftseinheiten identifiziert, bei denen die Wahrscheinlichkeit gering war, wieder in die Gewinnzone zu gelangen. Trotz hervorragender Technik haben wir diese Aktivitäten entweder veräußert oder eingestellt. Beispielsweise haben wir unsere Controller-Aktivitäten im Bereich Mobilfunkinfrastruktur beendet. Ein Teil des Glasfasergeschäfts wurde an Finisar veräußert, der überwiegende Teil unseres Geschäftsfelds Optische Netzwerke an Exar verkauft. Zudem haben wir strategisch wichtige Teile des Glasfasergeschäfts in das Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket integriert. Schon heute sehen wir, dass diese Entscheidungen richtig waren. Die beschriebenen Maßnahmen im Bereich drahtgebundene Kommunikation dienen dazu, das Geschäft zu fokussieren, und bereits heute verzeichnen die Breitband-Zugangsprodukte eine hervorragende Entwicklung mit signifikanten Marktanteilsgeinnen. Das Geschäftsfeld Drahtgebundene Kommunikation insgesamt ist heute so erfolgreich wie lange nicht mehr.

Bei zwei bedeutenden Aktivitäten haben wir Potenzial für eine profitable Fortführung identifiziert. Die beiden Bereiche, Basisbandprozessoren für Mobiltelefone und Sicherheits- und Chipkarten-ICs, setzen derzeit den definierten Restrukturierungsplan um. Bei Basisbandprozessoren haben wir einen aggressiven und konsequenten Plan entwickelt, mit dem wir neue Kunden gewinnen wollen. Er basiert auf der Weiterentwicklung unserer im Weltmarkt führenden Hochfrequenztechnologie sowie auf neuen Prozessoren für Mobiltelefone. Diese Technologie wird durch die UMTS/EDGE/GSM-Protokoll-Software vervollständigt. Insgesamt stellen wir damit dem Markt ein her-

vorrangend wettbewerbsfähiges Angebot für Mobilfunkplattformen zur Verfügung, die vom Einstiegssegment bis hin zum High-End-Segment skalierbar sind. Damit sollten wir gegen Ende des Geschäftsjahrs 2006 deutlich verbesserte Ergebnisse erwirtschaften. Infolge großer Anstrengungen zur Kostensenkung und Produktentwicklung ist absehbar, dass sich die Lage auch bei Sicherheits- und Chipkarten-ICs zum Ende des Kalenderjahrs 2006 wesentlich verbessern wird. Wir werden Produkte mit höherer Wertschöpfung wie Zugangstechnologien, Zahlungsverkehr und Identifikationssysteme stärker in den Mittelpunkt stellen. Die Verbesserung unserer Ertragslage hat in diesem Fall klar Vorrang vor der Sicherung unseres Weltmarktanteils, der bei knapp 40 Prozent liegt. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer Vorgabe, profitables Wachstum zu erzielen, erfolgreich sein werden.

Mit den genannten Maßnahmen haben wir das Unternehmen im abgelaufenen Jahr in jenen Bereichen neu aufgestellt, die den dringendsten Handlungsbedarf aufwiesen. Ich möchte mich damit den Schritten zuwenden, die wir im neuen Geschäftsjahr einleiten werden. Bereits seit längerem zeichnen sich grundlegende Änderungen in der Halbleiterindustrie ab. Vor allem stellen wir fest, dass sich das Wachstum des Halbleitersektors insgesamt verlangsamt. Stärker unterscheiden werden sich künftig auch die Wachstumsgeschwindigkeiten der einzelnen Segmente. Außerdem erleben wir eine immer weiter gehende Spezialisierung der Unternehmen bei Entwicklung und Fertigung. Bisherige Fertigungsmodelle werden sich auf Grund von Marktverschiebungen und Spezialisierungen nicht unverändert fortführen lassen. Zusätzlich rücken in bestimmten Segmenten Systemlösungen stärker in den Vordergrund als Einzelprodukte.

Diese Veränderungen machen ein größeres Maß an Differenzierung in der Unternehmensstruktur erforderlich, über die bereits vollzogene divisionale Aufstellung des Unternehmens hinaus. In der Vergangenheit konnten wir stets Synergien in der Fertigung von Speicher- und Logikprodukten innerhalb des gleichen Unternehmens erkennen und nutzen. Infolge der unterschiedlichen technischen Entwicklung nehmen diese Synergien künftig jedoch im Zeitverlauf ab. Märkte und Kunden sowie Produkt- und Prozessentwicklung von Speicherprodukten auf der einen und Logikprodukten auf der anderen Seite entwickeln sich verstärkt auseinander: Die hochvolumige Produktion von Speicherprodukten bleibt wegen der aufwändigen Technik äußerst kapitalintensiv und prozessorientiert. Für Logikprodukte sehen wir hingegen wesentlich differenziertere Märkte mit geringeren Produktionsvolumina der Einzelprodukte und mit wachsenden Anforderungen für Systemlösungen. Die enge Einbindung von Kunden in die Produktentwicklung ist hier ein zentraler Erfolgsfaktor. Unser Portfolio an Technologien und Fertigungsprozessen muss sich daher am Kundenbedarf orien-

tieren, eine zentral gesteuerte Bereitstellung der neuesten Fertigungsprozesse und Kapazitäten ist zu kostenintensiv. Zudem unterscheiden sich die Innovationsgeschwindigkeiten bei Speicher und Logik immer mehr. Während manche Logikprodukte Lebenszyklen von wenigen Jahren bis zu einem Jahrzehnt aufweisen, erneuern sich Speicherprodukte im Jahresrhythmus. Hier ist die schnellstmögliche Einführung der jeweils neuesten und kostengünstigsten Fertigungstechnologien gefragt, die mit einer hohen Kapitalintensität des Geschäfts verbunden ist.

Im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren sehen wir deshalb heute und für die Zukunft eine deutlich unterschiedliche Entwicklung bei Speicher- und Logikprodukten. Daraus resultieren andere Notwendigkeiten in Strukturen und Geschäftsmodellen sowie in Steuerung und Strategien.

Aus diesem Grund haben wir beschlossen, das Speichergeschäft rechtlich zu verselbstständigen. Ein späterer Börsengang ist unsere bevorzugte Option. Wir sind überzeugt, dass eine solche Trennung sowohl dem Bereich Speicherprodukte als auch dem Logikbereich eine Fülle von neuen Möglichkeiten eröffnet. Für den Speicherbereich bietet die Ausgliederung die Chance eines eigenen Kapitalmarktzugangs. Dies stellt in einer kapitalintensiven Industrie einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor dar. Auch erleichtert die rechtliche Selbstständigkeit dem Speicherbereich, Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen. Der Logikbereich des Unternehmens könnte Mittelzuflüsse aus dem Börsengang der Speichersparte verwenden, um das eigene Geschäft durch selektive Akquisitionen zu stärken. Schließlich haben Anleger nach Börsennotiz des Speicherbereichs die Möglichkeit, differenzierter zu investieren.

Wir werden aber nicht nur den Speicherbereich in eine selbstständig tätige Gesellschaft überführen, sondern auch in den Logikbereichen von Infineon einige Veränderungen vornehmen. So werden wir in Zukunft eine differenziertere Produktionsstrategie für Logikprodukte verfolgen. Für Bauteile, die in wesentlichen Teilen auf den Standardprozess der Halbleiterfertigung zurückgreifen, die so genannte CMOS-Technologie, investieren wir nicht in eigene Fertigungskapazitäten für 65-Nanometer-Technologien. Ingegnen werden wir die in den Bereichen Leistungs- und Hochfrequenzhalbleiter benötigten speziellen Fertigungsschritte nach wie vor im Unternehmen selbst vornehmen, da diese Spezialfertigungsfähigkeiten weiterhin einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor darstellen. In diesem Zusammenhang möchte ich unser neues Werk in Kulim, Malaysia, erwähnen, das wir ausschließlich für die Herstellung von Leistungshalbleitern für den Automobil- und Industriebereich errichten. Die Märkte für diese Produkte wachsen stetig, und Infineon ist hier in vielen Segmenten Marktführer. Im Herbst 2006 wird dieses Werk die Produktion aufnehmen.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen kurzen Ausführungen vermitteln, dass wir in den vergangenen Monaten ganz wesentliche Themen für das Unternehmen angepackt haben. Nach eingehender strategischer Bestandsaufnahme haben wir uns vorgenommen, die von uns identifizierten Maßnahmen konsequent umzusetzen. Wir haben es in der Hand, unsere Zukunft zu gestalten. Wir müssen alles daran setzen, dass 2006 ein besseres Jahr für uns wird, auch wenn der Marktausblick, den Experten für die Halbleiterindustrie geben, erneut von einem einstelligen Wachstum ausgeht.

Unsere Mitarbeiter zeigen trotz der Umstrukturierung und der Veränderung in ihrer Arbeit weiterhin Höchstleistungen und Hingabe an das Unternehmen. Dafür danke ich ihnen persönlich und im Namen des gesamten Vorstands. Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam bereits viel erreicht: eine erfolgreiche und wegweisende Neuorganisation, die Neuausrichtung und die Restrukturierung vieler Geschäftsfelder. Die noch vor uns liegenden Herausforderungen werden wir gemeinsam ebenso erfolgreich meistern.

München, im November 2005

Mit freundlichen Grüßen

Ihr



Dr. Wolfgang Ziebart
Vorsitzender des Vorstands

Der Vorstand der Infineon Technologies AG



von links:

Prof. Dr. Hermann Eul

Leiter des Segments Kommunikation

Studium der Elektrotechnik, Promotion zum Dr.-Ing.; Mitglied des Vorstands seit Juli 2005

Peter J. Fischl

Finanzvorstand und Arbeitsdirektor

Industriekaufmann; Mitglied des Vorstands seit April 1999

Dr. Wolfgang Ziebart

Vorsitzender des Vorstands

Studium des Maschinenbaus, Promotion zum Dr.-Ing.; Mitglied des Vorstands seit September 2004

Peter Bauer

Leiter des Segments Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

Studium der Elektrotechnik, Diplomingenieur; Mitglied des Vorstands seit April 1999

Kin Wah Loh

Leiter des Segments Speicherprodukte

Studium der Verfahrenstechnik, Bachelor of Science; Mitglied des Vorstands seit Dezember 2004

Die Infineon-Aktie

Infineon-Aktie kann vom allgemeinen Aufwärtstrend nicht profitieren

Kursniveau der Infineon-Aktie im Berichtsjahr nahezu unverändert.

DJ-Stoxx-Halbleiterindex steigt im Geschäftsjahr 2005 um 13 Prozent.

Im Durchschnitt wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr täglich 9,7 Millionen Infineon-Aktien gehandelt.

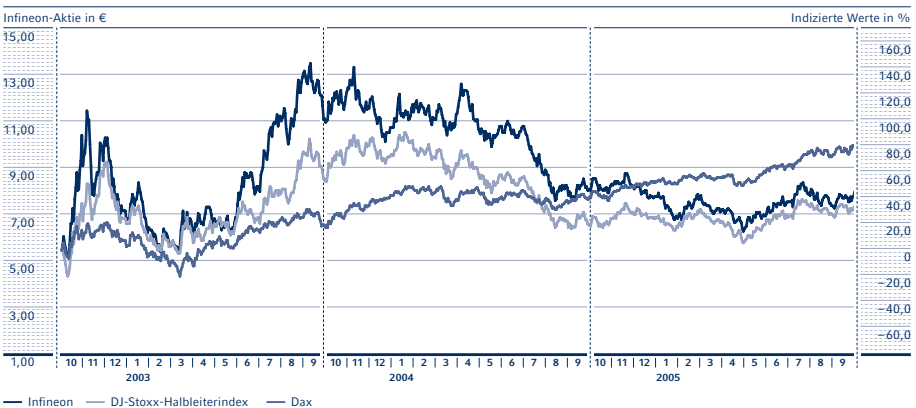
Chipaktien konnten im vergangenen Jahr nicht in vollem Umfang von der positiven Stimmung am Aktienmarkt profitieren. So stieg der DJ-Stoxx-Halbleiterindex nur um 13 Prozent, während die Indizes DJ-Stoxx-50 und Dax um 22 bzw. 30 Prozent zulegten. Der Grund: Die Gewinnschätzungen für viele Halbleiterwerte mussten teilweise wegen Unterauslastung der Kapazitäten als Folge des Abbaus zu hoher Lagerbestände bei ihren Kunden nach unten korrigiert werden.

Auch Infineon war von diesem Effekt betroffen, jedoch zusätzlich noch von dem starken Preisdruck im DRAM- und Chipkartengeschäft sowie von deutlichen Marktanteilsverlusten bei einem seiner größten Kunden im Mobilfunk. Das hat mit dazu beigetragen, dass sich die Infineon-Aktie im letzten Jahr schlechter als der Halbleitersektor entwickelte. Doch zu Beginn des Geschäftsjahrs hat sie sich zunächst im Einklang mit dem Markt bewegt und am 18. November 2004 das Jahreshoch von 9,00 Euro markiert. Anschließend kam es zu einem stärkeren Kursrückgang, der am 29. April 2005 mit dem

Jahrestief von 6,43 Euro sein Ende fand. Insbesondere in dieser Phase hat die Infineon-Aktie gegenüber anderen Halbleiteraktien an Boden verloren. Danach erholte sich die Aktie mit dem Markt und erreichte zum Ende des Berichtsjahrs den Kurs von 8,18 Euro, im Vergleich zu 8,22 Euro zum Ende des Vorjahrs. Durch das nahezu unveränderte Kursniveau hat sich auch die enttäuschende langfristige Kursentwicklung nicht verändert. Wie auch im Vorjahr verzeichnet die Infineon-Aktie einen Kursrückgang von 77 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis zum Börsengang am 13. März 2000. Im Vergleich zum DJ-Stoxx-Halbleiterindex hat die Infineon-Aktie im gleichen Zeitraum jedoch weniger an Wert verloren.

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie hat sich nach einem kontinuierlichem Anstieg seit dem Börsengang erstmals reduziert. So wurden im letzten Geschäftsjahr im Durchschnitt täglich 9,7 Millionen Infineon-Aktien auf Xetra, auf dem Frankfurter Parkett und an den Regionalbörsen gehandelt, was einem Rückgang von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dennoch repräsen-

Relative Entwicklung von Infineon Technologies, DJ-Stoxx-Halbleiterindex und Dax seit Beginn des Geschäftsjahrs 2003 (Schlusskurse)



tierte dieses Volumen 9,5 Prozent des gesamten Dax-30-Handelsvolumens im selben Zeitraum. Nur ein Unternehmen im Dax-30 konnte ein höheres Handelsvolumen verzeichnen.

Kursdaten der Infineon-Aktie

Geschäftsjahr zum 30.9.	2004	2005
Europa Xetra-Schlusskurse in €		
Höchstkurs	13,65	9,00
Tiefstkurs	7,80	6,43
Jahresendkurs Ende September	8,22	8,18
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag in Stück	11.743.938	9.666.303
davon auf Xetra in %	96	97
USA NYSE-Schlusskurse in US-Dollar		
Höchstkurs	15,87	11,47
Tiefstkurs	9,39	8,40
Jahresendkurs Ende September	10,22	9,92
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag in Stück	896.317	583.101

Langfristige Entwicklung Infineon-Aktie und Indizes in %

Zeitraum zum 30.9.2005	Seit IPO am 13.3.2000	Seit Oktober 2003	Seit Oktober 2004
Europa			
Infinion (Xetra)	-77 ¹	-27	0
DJ-Stoxx-Halbleiter	-84	-13	13
DJ-Stoxx-Technologie	-75	29	21
DJ-Stoxx-50	-35	37	22
Dax	-34	55	30
USA			
Infinion (NYSE)	-71 ¹	-23	-3
Philadelphia Semiconductor Index (SOX)	-64	13	24

1 Basiert auf dem Ausgabepreis von 35 Euro bzw. 33,92 US-Dollar.

Grundkapital, Anzahl Aktien und Marktkapitalisierung Infineon Technologies AG

Stichtag	30.9.2004	30.9.2005	Entwicklung
Grundkapital in Mio. €	1.495	1.495	0 %
Ausstehende Aktien in Mio. ¹	748	748	0 %
im Jahresdurchschnitt in Mio. ¹	735	748	+2 %
Marktkapitalisierung in Mio. €	6.149	6.119	0 %
Marktkapitalisierung in Mio. \$	7.645	7.420	-3 %

1 Unverwässert.

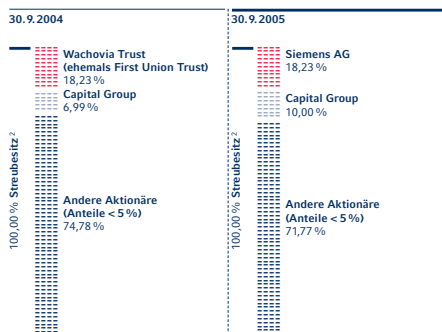
Infinion zahlt keine Dividende

Vorstand und Aufsichtsrat können der Hauptversammlung keine Dividendenzahlung vorschlagen, da die Muttergesellschaft des Konzerns, die Infineon Technologies AG, keinen Bilanzgewinn ausweist. Der entsprechende Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2005 beträgt 1.546 Millionen Euro im Vergleich zu einem Bilanzverlust in Höhe von 1.209 Millionen Euro im Vorjahr.

Aktionärsstruktur

Im Berichtsjahr gab es zwei mitteilungspflichtige Veränderungen in der Aktionärsstruktur, die Infineon bekannt sind. Zum einen hat die Capital Group ihren Anteil bis zum 12. Mai 2005 auf 10,00 Prozent erhöht. Zum anderen wurden die Anteile im Besitz der Wachovia Trust Company National Association am 28. November 2004 an Siemens zurückübertragen. Dadurch ist Siemens wieder berechtigt, die Stimmrechte aus diesen Anteilen auszuüben.

Aktionärsstruktur¹



1 Gemäß der Infineon bekannten Pflichtmeldungen.

2 Streubesitz gemäß Definition von FTSE. Deutsche Börse und Stoxx berechnen den Infineon-Streubesitz ohne die Anteile von Siemens bzw. des Wachovia Trust.

Für Fragen steht das Investor-Relations-Team von Infineon in München und San Jose/Kalifornien, USA, jederzeit zur Verfügung.

Büro München
Tel. +49 (0)89 234-26 655
Fax +49 (0)89 234-26 155

Büro San Jose
Tel. +1 408 501 6800
Fax +1 408 392 8023

E-Mail
investor.relations@infineon.com

512M GDDR3

Die anspruchvollsten Kunden unter den Computerkäufern sind die Grafikanwender. Sie benötigen äußerst schnelle Grafikspeicher, die sie in Spielekonsolen und Grafikkarten einsetzen. Wirkliche Spielfreude entsteht bei ihnen nur bei einem reibungslosen Bildaufbau der komplizierten Grafiken, Szenen und Animationen. Nur ganz wenige Hersteller haben dafür Bausteine im Programm. Bei uns ist es der 512M GDDR3.



Infinion Technologies Kurzbericht 2005

Unser Unternehmen



Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket Elektronik sorgt für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort

Unsere Halbleiter für die Automobilelektronik entsprechen industrieweit höchsten Qualitätsanforderungen. Durch die flexible Ansteuerung von Motoren und Lampen lässt sich der Energieverbrauch senken. Wir liefern höchste Sicherheit für Ausweise, Pässe und in Netzwerken.

Automobil: von Kraftstoffeinsparung und Fahrgastsicherheit bestimmt

In der Automobilindustrie sind Autohersteller und Elektronikzulieferfirmen auf Grund der langen Produktlebenszyklen auf hohe Planungssicherheit und dauerhafte Kundenbeziehungen angewiesen. Auch Infineon, in Europa Nummer eins und weltweit Nummer zwei im Automobilssektor, pflegt hier stabile Geschäftsbeziehungen, direkt zu mehr als 200 Kunden und indirekt über unsere Distributionspartner zu mehreren tausend. Viele der Kunden kommen aus Europa, wo nach wie vor die meisten Innovationen rund ums Auto hervorgebracht werden.

Ausgelöst von dem stärkeren Sicherheits- und Komfortbewusstsein der Autofahrer steigt seit Jahren der Elektronikanteil und damit auch die Anzahl der Halbleiter im Auto. Für alle Produkte in der Automobilbranche und die zugehörigen Halbleiter ist Qualität dabei oberstes Gebot. Um den höchsten Anforderungen zu genügen, hat Infineon das Automotive-Excellence-Programm gestartet. Ziel dieses Programms ist, Bauteildefekte vollkommen auszuschließen. Im Juli 2005 hat uns Continental Automotive Systems als erstes Halbleiterunternehmen zum „Lieferant des Jahres 2004“ ernannt – ein deutlicher Beleg für die erfolgreiche Umsetzung dieses Programms.

Auch technische Entwicklungen zu Kraftstoffeinsparung und Emissionsminderung werden immer wichtiger. Die in der Motor- und Getriebesteuerung eingesetzten 32-Bit-Controller aus unserer TriCore-Familie, allen voran der → **TriCore TC1796**, ermöglichen durch ihre enorme Rechenleistung einen höheren Wirkungsgrad des Motors und erfüllen höchste Anforderungen an die Leistung bei zugleich optimiertem Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß.

Ein weiterer Trend im Auto ist der Ersatz mechanischer und hydraulischer Baugruppen durch elektrische Systeme. Hierbei müssen hohe Ströme bei minimaler Wärmeentwicklung geregelt werden. Speziell für Automobilanwendungen hat Infineon die Produktfamilie → **OptiMOS-T** entwickelt.

Höhere Ansprüche an die Sicherheit beim Autofahren und neue Regelungen in der Verkehrssicherheit haben die Entwicklung von Sensoren wie Druck-, Gierraten-, Magnetfeld-, Aufprall- und Überrollsensoren vorangetrieben. Dieses Segment von Automobilhalbleitern verspricht weiterhin höchste Wachstumsraten.

Industrie: Wirkungsgrad erhöhen und Bauteile verkleinern

Im letzten Geschäftsjahr hat Infineon sein Engagement im Industriegeschäft neu ausgerichtet und dafür seine Mikrocontroller-Familien sowie das Power-Produktportfolio, beispielsweise rund um die Antriebssteuerung von Elektromotoren, ausgebaut. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Entwicklung von Leistungstransistoren mit höherem Wirkungsgrad und der Verkleinerung von Baugruppen und Modulen für Netzteile. Schaltnetzteile, wie sie etwa in PCs, Notebooks und anderen Geräten der Unterhaltungselektronik vorkommen, stehen daher bei uns im Vordergrund; aber auch elektrische Antriebe für Klimaanlage, Waschmaschinen, Industrieautomation, Züge und Windkraftanlagen sind Endanwendungen dieser Bauteile.

Die programmierte Steuerung macht auch vor der Energiewandlung und der Laststeuerung nicht Halt. Werden Verbraucher wie Motoren und Pumpen flexibel je nach Last angesteuert und nicht mehr nur durch einfaches Ein oder Aus, lässt sich der Energieverbrauch deutlich senken. Der Fachmann nennt das variable speed drive. Die digitale Ansteuerung von Leistungshalbleitern, auch digitales Power-Management genannt, ist bei Industrie- und Automobilanwendungen im Kommen.

Chipkarte: höchste Sicherheitsanforderungen im Vordergrund

Die Wachstumstreiber bei den Sicherheitschips sind Personenidentifikation (Pässe, Personalausweise, Gesundheitskarten) und Zahlungsmittel (Geldkarten und Kreditkarten). Kontaktbasierte wie kontaktlose Chipkarten müssen höchste Ansprüche in Bezug auf Sicherheit und Leistung erfüllen.

Aber auch SIM-Karten haben vor allem durch das starke Wachstum des Mobiltelefonmarkts in den Schwellenländern weiter an Bedeutung gewonnen. Die niedrigen Sicherheitsstandards für die Karten in diesen Ländern führten allerdings zu geringen Eintrittsbarrieren und damit einem hohen Wettbewerbsdruck für Chiphersteller. Karten mit Speicherkonfigurationen von 8 bis 64 Kilo-byte sind 2005 endgültig zum Standardgeschäft mit den hierbei üblichen geringen Margen geworden. Um die Profitabilität des Geschäfts zu steigern, führen wir neue kostenreduzierte Versionen ein und verstärken unser Portfolio im Bereich kontaktlose Sicherheitsanwendungen. So haben wir zum Beispiel im vergangenen Geschäftsjahr neben einer neuen Fertigungstechnologie die Speichertechnologie → **MicroSlim** sowie die Modulbestückungstechnologie Flip Chip On Substrate (→ **FCOS**) auf den Markt gebracht.

Der frühe Eintritt in die PC- und Netzwerksicherheit mittels Trusted Platform Modules (TPM) zählt sich aus. Die Chips der aktuellen Version (→ **TPM 1.2**) werden in den nächsten Monaten von den PC-Herstellern in ihre ersten Produkte eingebaut. Infineon liefert als einziger Hersteller Chips und Software aus einer Hand.

ASIC & Design Solutions: kundenspezifische Chips mit hoher Systemexpertise

Mit der Geschäftseinheit ASIC & Design Solutions übertragen wir vorhandenes Know-how, Patente und Systemexpertise in neue Produkte, die in enger Kooperation mit unseren Kunden entwickelt werden. So können wir Entwicklungsphasen kurz halten und unseren Kunden eine schnelle Markteinführung ermöglichen. Jüngstes Beispiel ist die Kooperation mit Microsoft, zu dessen Spielekonsole Xbox 360 wir drei Komponenten (→ **steckbares Speichermodul, Sicherheitschip, Gamepad-Controller**) beisteuern.

Standorte in Asien und Europa ausgebaut

Der Bau unserer neuen Fabrik für die Produktion von Leistungshalbleitern im Automobil- und Industriebereich im Kulim-High-Tech-Park, Malaysia, verläuft planmäßig. Im März 2006 werden voraussichtlich die ersten Reinraummaschinen eingestellt, der Produktionsstart ist für das letzte Kalenderquartal 2006 geplant. Mit dieser Investition sorgen wir für die nötige Ausweitung unserer Fertigungskapazität zur Unterstützung unseres

Wachstums sowie für eine erhebliche Senkung der Fertigungskosten durch einen niedrigeren Lohnkostenanteil dieses Werkes.

Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir auch unsere Entwicklungsaktivitäten ausgebaut. So haben wir im April 2005 in Bukarest, Rumänien, ein neues Entwicklungszentrum eröffnet und in Villach, Österreich, sowie in Padua, Italien, die bestehenden Forschungszentren erweitert.

Innovationsbox

TriCore TC1796

Die Motorsteuerung zählt zu den rechenintensivsten und zeitkritischsten Aufgaben im Auto. Für diese anspruchsvollen Berechnungen im Echtzeitbetrieb haben wir die 32-Bit-Mikrocontroller-Familie TriCore konzipiert. Der TC1796 ist mit 40 Millionen Transistoren unser bisher komplexester Baustein im Automobilbereich.

OptiMOS-T

Gleichspannungswandler beispielsweise in Notebooks oder Servern, aber auch im Auto sind typische Anwendungen für unsere OptiMOS-Produktfamilie. Speziell für den Automobilbereich wurde die neue Trench-55V-Technologie (OptiMOS-T) entwickelt.

MicroSlim

Die Speicher, basierend auf der MicroSlim-Technologie, können künftig mit nur noch einem Transistor pro Bit-Zelle statt wie bisher zwei gebaut werden. Das spart Platz auf dem Chip und Kosten in der Herstellung.

FCOS

Flip Chip On Substrate (FCOS) ist ein neues Verfahren, das Siliziumplättchen mit den goldenen Kontaktflächen einer Chipkarte verbindet. Man setzt den Chip dabei mit der Oberfläche nach unten (flip chip) auf den Träger (substrate).

TPM 1.2

Die zweite Generation von TPM-Chips wurde an unsere Kunden, PC- und Notebook-Hersteller, ausgeliefert. Wir sehen langfristig auch Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und Mobiltelefone als Anwendungsfelder.

Steckbares Speichermodul, Sicherheitschip, Gamepad-Controller

Solche ASICs wandern in die Grundausstattung oder in die Accessoires. Mit dem steckbaren Speichermodul können Spielstände gespeichert werden. Der Sicherheitschip sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel der Accessoires. Und der Gamepad-Controller ist durch unsere Funkchips kabellos.

Kommunikation

Drahtgebundene und mobile Kommunikation wachsen zusammen

Wir ermöglichen preiswerte Telefone für Schwellenländer und Multimedia-Telefone für höchste Ansprüche. Unsere VDSL2-Lösung sorgt für Rekordraten bei der Datenübertragung. Wir vernetzen drahtgebundene und mobile Kommunikationsgeräte im digitalen Heim.

Bewegung in der Kommunikationstechnologie

Eine erfreuliche Entwicklung des vergangenen Jahres war die starke Nachfrage nach Mobiltelefonen in Schwellenländern. Sie erklärt größtenteils das starke Wachstum von 520 Millionen Geräten im Jahr 2003 auf 674 Millionen 2004, das übrige Wachstum ergab sich aus dem Ersetzen vorhandener Modelle. Durch das weitere Absenken des Preises für Einstiegsmodelle wird sich dieser Trend wohl 2006 fortsetzen. Preiswerte Mobiltelefone bieten Sprach- und Textübertragungsfunktionen und verzichten auf Extras wie Spiele oder Kameras. Die Herstellungskosten sollen schon 2006 unter 20 US-Dollar liegen.

Das Mobiltelefongeschäft ist ferner von einer schnelleren Einführung neuer Produktgenerationen und einem zunehmenden Integrationsgrad der elektronischen Komponenten gekennzeichnet. Zusatzfunktionen wie Kamera oder MP3-Spieler treiben die Komplexität der Chips nach oben. Auf Grund der schnellen Kostensenkungen erwarten wir 2006 jedoch wertmäßig eine flache oder gar fallende Entwicklung des weltweiten Halbleitersatzes für den Mobilfunkmarkt.

Bei der drahtgebundenen Kommunikation sehen wir die Konvergenz von Sprach-, Daten- und TV-Netzwerken als eine übergeordnete Entwicklung mit vielfältigen Auswirkungen: Bei der digitalen Sprachübertragung (Voice-over-IP) werden gesprochene Worte nicht mehr analog über die Telefonleitung, sondern in digitalisierten Häppchen über ein Rechnernetzwerk übertragen. In neuen Firmengebäuden wie unserer Unternehmenszentrale Campeon, Hotels oder Universitäten werden daher praktisch keine Telefonleitungen mehr verlegt. Mehr noch: Es ist zu erwarten, dass die Telekommunikationsunternehmen in Zukunft von Sprachnetzen auf Internet-Protokoll-basierte Datennetze umrüsten und damit erhebliche Einsparpotenziale realisieren.

Ausgehend von ISDN gilt nach ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL nun VDSL2 als vorerst leistungsfähigster Übertragungsstandard für die Strecke vom Netzbetreiber über die Kupferleitung zum Endkunden (letzte Meile). VDSL2 erlaubt mit einer Bandbreite von bis zu 100 Megabit pro

Sekunde „Triple Play“, also die Übertragung von mehreren Fernsehkanälen in HDTV-Qualität, Sprachübertragung und einen schnellen Internet-Zugang. Auch im privaten Wohnbereich schreitet die drahtgebundene und drahtlose Vernetzung von Unterhaltungselektronikgeräten weiter voran. Home-Gateway-Lösungen bilden die Funktion von integrierten Zugangspunkten von Sprach-, Video- und Datendiensten im Haus und übernehmen die Funktion von Routern zur Einrichtung und Steuerung von Heimnetzwerken.

Für jeden Trend das richtige Produkt

Als Spezialist für Kommunikationstechnologien unterstützen wir mit GSM, GPRS, EDGE und UMTS die wesentlichen Mobilfunkstandards der Welt. Telefonhersteller konzentrieren sich zunehmend auf Funktionalitäten, die Produktpalette sowie das Design und beziehen komplette Systemplattformen von den Chiplieferanten. Entsprechend konsequent haben wir unsere Software- und Systementwicklung vorangetrieben und decken heute mit verschiedenen Plattformen sämtliche Marktsegmente ab (→ **Referenz-Plattformen ULC** und **MP-E**). Für kostengünstigere Telefone haben wir die Ultra-Low-Cost(ULC)-Plattform mit der 1-Chip-Lösung → **E-GOLDradio** entwickelt, in der Basisband und Hochfrequenz-Transceiver auf einem Chip in der CMOS-Technologie integriert sind. Für das mittlere Marktsegment integrieren wir die populärsten Multimedia-Anwendungen in unsere Basisband-Chips. Unser S-GOLD2 ist der erste Vertreter dieser neuen Generation. Für diese Chips entwickeln wir auch die entsprechende Software wie beispielsweise EDGE- und UMTS-Protokolle sowie mit dem Produkt APOXI eine Plattform für Applikationssoftware. Für das Smartphone-Segment stellen wir durch entsprechende Software die Kompatibilität unserer Basisband-Chips mit den marktgängigen Applikationsprozessoren sicher, die Infineon nicht selbst entwickelt.

Im Bereich der drahtlosen Kommunikation hat Infineon bei Hochfrequenz-Transceivern den Übergang von der BiCMOS- zur CMOS-Fertigungstechnologie maßgeblich vorangetrieben. Mit dem SMARTi SD brachte Infineon den weltweit ersten Single-Chip-CMOS-Transceiver für GSM und GPRS in großen Stückzahlen auf den Markt,

gefolgt vom → **SMARTi PM** für EDGE und dem → **SMARTi 3G** für UMTS.

Als Markt- und Technologieführer bei Hochfrequenz-Transceivern konzentrieren wir uns auf Connectivity Solutions, also die Kombination unterschiedlicher Funkstandards wie WLAN, GPS, Bluetooth oder DECT in einem Gerät oder gar auf einem Chip. In der Herstellung von Chips für den digitalen Fernsehempfang ist Infineon ebenfalls führend und am Start des digitalen Zeitalters für das Antennenfernsehen DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) ganz entscheidend beteiligt (→ **DVB-T-Empfänger**). Und auch auf dem Handy kann man bereits fernsehen – in Korea als weltweit erstem Land. Dort sind die ersten Geräte mit unseren Empfängern erhältlich.

Höchstgeschwindigkeit auf der letzten Meile

Darüber hinaus punkten wir mit unseren Chips bei der digitalen Sprachübertragung in Rechnernetzen (Voice-over-IP). Die exzellente Qualität unserer Produkte bei den DSL-Zugangstechnologien (→ **GEMINAX Pro**, **VINAX**) sichert uns einen Wettbewerbsvorteil beim Stromverbrauch und bei der Leistungsfähigkeit der DSL-Leitungen. Infineon ist eines der wenigen Unternehmen, die beide Seiten der Kommunikationsleitung umfassend bedienen – vom Vermittlungssystem bis hin zum einzelnen Nutzer. So stellen wir durchgehende xDSL-Zugangstechnologien für Anwendungen wie Broadband-in-the-Home und digitales Home-Networking her und bieten mit den Halbleitern für Teilnehmeranschlusseinrichtungen (Customer Premises Equipment) komplette Breitband-Kommunikationslösungen an. Zusätzlich können unsere Kunden aus einer umfassenden Palette an traditionellen Produkten für analoge Telefonanschlüsse, ISDN-Anschlüsse und T/E Carrier auswählen.

Forschung & Entwicklung sowie Kooperationen

Ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten ist der Ausbau unserer Prozesstechnologien. Um hierbei einen Wettbewerbsvorteil zu möglichst niedrigen Kosten zu sichern, sind wir beispielsweise mit IBM, Chartered Semiconductor Manufacturing und Samsung und auch mit Konsortien Allianzen eingegangen. So läuft in der 130-Nanometer-Technologie die Volumenproduktion, in der 90-Nanometer-Technologie fahren wir gegenwärtig einige Produkte hoch, und in der 65-Nanometer-Technologie wurde die Qualifikationsphase gestartet. Der 45-Nanometer-Prozess ist bereits in Entwicklung.

Innovationsbox

Referenz-Plattform ULC

Telefone, basierend auf dieser Referenz-Plattform für GSM/GPRS-Mobiltelefone der untersten Preisklasse, haben weniger als 100 Bestandteile. Die hierfür erforderliche Elektronik passt auf 9 cm². Telefone der gehobenen Preisklasse haben demgegenüber über 200 Komponenten und benötigen rund 30 cm² Platinenfläche. Der als Basisband-Chip eingesetzte E-GOLDradio unterstützt neben der Sprachtelefonie noch SMS und ein Farbdisplay. Telefone zu Herstellungskosten von unter 20 US-Dollar werden damit künftig möglich.

Referenz-Plattform MP-E

Unsere Referenz-Plattform für GSM/GPRS/EDGE-Multimedia-Mobiltelefone im mittleren Preissegment basiert auf dem S-GOLD2. MP-E unterstützt alle üblichen Frequenzbänder sowie Kamera, mehrstimmige Klingeltöne und Farbdisplay. Solche Plattformen werden von Mobiltelefonherstellern, die eine komplette Lösung aus einer Hand wünschen, nachgefragt.

E-GOLDradio

Vereinigt einen 4-Band-Hochfrequenz-Transceiver und einen Basisbandprozessor auf einem Chip. Damit ist er weltweit die erste und höchstintegrierte monolithische 1-Chip-Lösung der beiden wichtigsten Komponenten eines Mobiltelefons. Zugeschritten auf GSM/GPRS-Mobiltelefone der unteren und mittleren Preisklasse.

SMARTi PM

Weltweit erster CMOS-basierter Hochfrequenz(HF)-Transceiver für den EDGE-Standard.

SMARTi 3G

Weltweit erster Hochfrequenz-Transceiver, der alle sechs Frequenzen der 3G-Standards unterstützt. Damit kann er in allen UMTS-Telefonen der Welt eingesetzt werden. Weiterer Pluspunkt: Er wird auch in der Strom sparenden und kostengünstigeren CMOS-Technologie gefertigt.

DVB-T-Empfänger

Damit ermöglichen wir den Empfang von terrestrisch ausgestrahlten, digitalen Fernsehsignalen. Wird von Herstellern von Fernsehempfängern und Set-Top-Boxen eingesetzt.

GEMINAX Pro

In den Vermittlungsstellen der Netzbetreiber spielen Stromverbrauch, Packungsdichte und Systemkosten der Teilnehmeranschlusskarten eine entscheidende Rolle. Der GEMINAX Pro hat für den ADSL2+ Standard Zeichen gesetzt.

VINAX

Der Chip unterstützt die volle VDSL2-Spezifikation und erlaubt darüber hinaus die industrieweit größte Reichweite bei Datenraten von 100 Megabit pro Sekunde. Er kommt sowohl in den Vermittlungsstellen als auch beim Endkunden zum Einsatz und ist einer der komplexesten Chips, die wir je entwickelt haben.

Speicherprodukte Schnell und innovativ im Geschäft mit Speichern

Mit einem stetig wachsenden Produktportfolio bedienen wir die neuesten Trends auf dem Elektronikmarkt. Unsere DRAMs bieten industrieweit mit den geringsten Stromverbrauch und die höchste Geschwindigkeit. Mit der planmäßigen Einführung der 90-Nanometer-Prozesstechnik sichern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit.

Das Geschäft mit Speichern – zyklisch und schnell

Workstations, Desktop- und Notebook-PCs machen mit rund 50 bis 60 Prozent den größten Anteil bei DRAM-Speicherchips aus. Server und Netzwerkinfrastruktur folgen mit etwa 20 bis 30 Prozent. Unterhaltungselektronik sowie Telekommunikation gehören mit je unter zehn Prozent zu den kleineren Marktsegmenten. Dabei verbucht gerade die Telekommunikation die höchsten Wachstumsraten, angetrieben von dem hohen Anspruch an Volumen und Speicherausstattung bei Mobiltelefonen.

Marktforscher erwarten für die nächsten Jahre einen Anstieg der DRAM-Nachfrage in Bit um etwa 50 Prozent pro Jahr. Dieses Marktwachstum bewältigen Halbleiterhersteller zum großen Teil, indem sie immer fortschrittlichere Fertigungstechnologien einführen. Den Rest leisten Investitionen in neue Produktionsanlagen. Das Geschäft mit Speicherprodukten zeichnet sich somit durch einen hohen Kapitaleinsatz aus; Angebots- und Nachfragewachstum sind starken Schwankungen ausgesetzt. Dies führt zu deutlichen Schwankungen im Preisverlauf und einer zyklischen Entwicklung von Umsatz- und Ertragslage. Entsprechend der aktuellen Preisentwicklung konfigurieren die PC-Hersteller ihre Modelle. Bei niedrigen DRAM-Preisen werden PCs mit hoher Speicherausstattung gebaut und umgekehrt.

Im Mittelpunkt des Interesses der DRAM-Hersteller steht derzeit die neueste Generation von Spielekonsolen. Für die Darstellung der hochqualitativen Grafiken benötigen diese Geräte die industrieweit schnellsten Speicher, die nur von wenigen Herstellern entwickelt und gefertigt werden – Infineon ist einer von ihnen. Im Unterschied zu PCs handelt es sich bei Spielekonsolen um ein bezüglich Nachfrage und Preisentwicklung stabileres Geschäft, das enge Beziehungen zum Speicherlieferanten erfordert.

Die immer größere Vielfalt an mobilen Anwendungen wie Digitalkameras, Smartphones und PDAs erfordert zunehmend Speicherbausteine mit geringem Stromverbrauch. Aber auch für Hochleistungsserver und Grafiksysteme in Notebooks werden Strom sparende Speicher benötigt, um die Wärmezeugung unter Volllast so ge-

ring wie möglich zu halten. Unsere DRAM-Produkte zeichnen sich dabei durch einen besonders niedrigen Stromverbrauch aus.

Eine der interessantesten Entwicklungen im gesamten Halbleitermarkt war das rasante Wachstum bei NAND-Flash-Speichern. Sie finden sich in austauschbaren Speichermedien wie MultiMediaCard, SD Card, Memory Stick oder USB-Stick, die in Digitalkameras und MP3-Playern für hohe Speicherkapazität sorgen. Auch Infineon bietet Flash-Karten verschiedener Formate an, derzeit noch mit vergleichsweise kleinen Speicherdichten. In den nächsten Jahren werden wir hier unsere Entwicklung gezielt beschleunigen, um den Vorsprung der Marktführer in diesem schnell wachsenden Segment aufzuholen.

Auf Marktbedingungen flexibel reagieren

Im Markt für Speicherprodukte sind Innovationen und Flexibilität die im Wettbewerb entscheidenden Voraussetzungen für profitables Wachstum. Infineon ist in der Lage, durch seine modernsten Fertigungstechnologien die Kosten der Speicherproduktion Jahr für Jahr deutlich zu senken. So wurde im Juni 2005 mit der Umstellung auf den → **90-Nanometer-Fertigungsprozess** für DRAMs begonnen. Zudem haben wir neue Kapazitäten in der 300-Millimeter-Technologie geschaffen, bei der Infineon die Vorreiterrolle einnimmt und mit der sich Speicher noch wirtschaftlicher produzieren lassen. Dadurch wollen wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft die Produktivität bei der Herstellung von Speicherbausteinen jährlich um etwa 30 Prozent steigern können. Im Februar 2005 haben wir bereits einen DRAM-Prototyp vorgestellt, der auf dem künftigen → **70-Nanometer-Fertigungsprozess** basiert.

Seit Mitte der neunziger Jahre haben wir unsere Wettbewerbsposition im DRAM-Markt deutlich verbessert. Mit einem Marktanteil von nunmehr 14 Prozent gehören wir zu den vier Schwergewichten weltweit. Um unser Ziel eines weiteren, profitablen Wachstums zu erreichen, treiben wir die Kostensenkung durch Produktivitätssteigerung voran und richten unser Produktportfolio auf Marktsegmente aus, die ein höheres Preisniveau und

geringere Preisschwankungen aufweisen. Wir sind überzeugt, das Speichersegment auf diesem Weg zu einer verbesserten Rentabilität zu führen.

Wir haben uns in den letzten Jahren einen Namen als innovativer Lieferant von Speichermodulen (→ **FB-DIMM**) für Server erarbeitet. An dieses Computersegment liefern wir heute bis zu 30 Prozent unserer Speicherchips und erzielen im Vergleich zu üblichen PC-Modulen höhere und stabilere Margen. Bei den Grafikspeichern oder → **Graphics RAMs**, die auf höchste Schreib- und Lesegeschwindigkeit ausgerichtet sind, liegt Infineon technologisch im Spitzenfeld. Die frühzeitige Entwicklung der nächsten Speichergenerationen (→ **DDR3**) und die führende Position bei der Einführung neuer Speichermodultypen (→ **Micro-DIMM**) stellen weitere Schritte auf dem Weg zu profitablen Wachstum dar.

Um den Anforderungen einer Vielzahl von Herstellern von PCs und Notebooks, insbesondere in den stark wachsenden PC-Märkten der Schwellenländer, Rechnung zu tragen, haben wir unsere Zweitmarke „Aeneon“ eingeführt. In der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern verstärken wir unser Engagement in einem stark fragmentierten Kundensegment.

Ausbau von Entwicklung und Fertigung

In unserer 300-Millimeter-Fabrik in Richmond/Virginia, USA, haben wir im September 2005 mit der Serienfertigung von Speicherchips begonnen. Darüber hinaus setzen wir auch in Zukunft auf Kooperationen, um unsere Kapazitäten auszubauen und neue Produkte und Prozesse zu entwickeln. Risiken und Kosten lassen sich auf diese Weise teilen und Projekte auf eine breite Ressourcen- und Finanzbasis stellen. Auch unsere Fertigungskooperationen mit Winbond in Taiwan und SMIC in China verlaufen planmäßig. Die neue 300-Millimeter-Fabrik von SMIC in Peking wurde mit unserer 110-Nanometer-Technologie hochgefahren. Zusätzlich fertigt SMIC für uns in einer 200-Millimeter-Fabrik bei Shanghai. Mit Nanya betreiben wir das Fertigungs-Joint-Venture Inotera Memories, aus dem Infineon die Hälfte der Produktion erhält. Ende 2005 erfolgte der Transfer unserer 90-Nanometer-Technologie zu Inotera. Zusätzlich haben wir unsere langjährige Entwicklungskooperation mit Nanya erweitert. Neben der gemeinsamen Entwick-

lung der 90-Nanometer-Technologie und den laufenden Aktivitäten zur 70-Nanometer-Technologie werden wir nun auch die 60-Nanometer-Technologie gemeinsam auf den Weg bringen.

Innovationsbox

90-Nanometer-Fertigungsprozess

Dieser Fertigungsprozess erlaubt kleinere Strukturgrößen. Damit reduziert sich die Chipfläche um rund 30 Prozent gegenüber der heutigen 110-Nanometer-Technologie. Infineon ist der zweite DRAM-Hersteller, der diese Fertigungstechnologie einführt. Kleinere Chips bedeuten mehr Chips pro Wafer und damit geringere Herstellungskosten. Mit der 90-Nanometer-Technologie steigt die Anzahl der 512-Megabit-Chips pro 300-Millimeter-Wafer auf über 1.000 Stück.

70-Nanometer-Fertigungsprozess

Erste Prototypen wurden bereits Anfang des Geschäftsjahrs vorgestellt. Der Start der Volumenproduktion ist für das Kalenderjahr 2006 vorgesehen.

FB-DIMM

Ab Ende 2005 sollen die neuesten Server mit diesem Speichermodulformat (Fully Buffered-Dual Inline Memory Module) ausgestattet werden. Der hierzu erforderliche AMB (Advanced Memory Buffer) ist ein komplexer Logikchip, der die Signale bündelt und mit hoher Geschwindigkeit über die Datenleitungen in Richtung Prozessor sendet. Infineon ist der einzige Hersteller, der neben den Speicherchips auch den AMB fertigen kann. Erste Muster wurden im Frühjahr 2005 vorgestellt.

Graphics RAM

Entwickelt für das oberste Leistungssegment mit Taktraten von bis zu 800 Megahertz. Diese Königsklasse der DRAM-Speicher findet als Arbeitsspeicher auf Grafikkarten und in Spielekonsolen ihre Anwendung. Hersteller von 3D-Grafikkarten und Spielekonsolen haben höchste Ansprüche: Bei den heutigen Computerspielen mit fotorealistischen Szenen und ruckelfreier Bildwiederholrate müssen mehrere Millionen Polygone pro Sekunde berechnet werden. Da darf der Zugriff auf den Grafikspeicher nicht zum Engpass werden.

DDR3

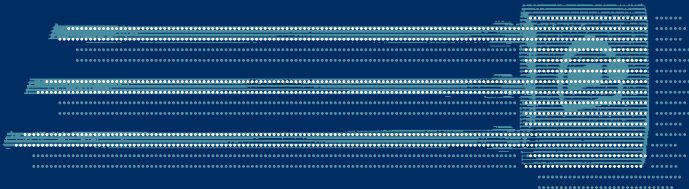
Die ersten Speichermodule, basierend auf der nächsten Generation der Standardspeicher, wurden 2005 vorgestellt. Die Markteinführung wird für 2007 erwartet. Bis 2012 ist DDR3 dann das Massenprodukt für PCs, Notebooks, Workstations und Server.

Micro-DIMM

Kleines Speichermodulformat für Sub-Notebooks.

HALL-SENSOR

Um Sicherheitskonzepte im Auto umsetzen zu können, muss eine Vielzahl von physikalischen Größen gemessen werden. Dies leisten Temperatursensoren oder Aufprallsensoren für den Airbag. Die eher unbekannteren Magnetfeldsensoren überwachen die Stellung von Pedalen und Scheiben oder die Position von Schalthebeln und Schaltern. Für all diese Funktionen sind hochpräzise Messungen nötig. Dies erfüllt bei uns der Hall-Sensor.



Auszug Finanzbericht



Auszug Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2005

ÜBERBLICK ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2005

Im Geschäftsjahr 2005 entwickelte sich die Weltwirtschaft schwächer als im Vorjahr, und der Halbleitermarkt erlebte eine Phase moderaten Wachstums. Als Global Player auf dem Halbleitermarkt wurde unser Geschäft von dieser ungünstigen Weltwirtschaftslage und den schwierigen Marktbedingungen auf dem Halbleitermarkt nachteilig beeinflusst, insbesondere von dem starken Preisdruck und zusätzlich von der rückläufigen Nachfrage in unseren operativen Segmenten. Um die derzeitigen Herausforderungen des Halbleitermarkts anzunehmen, haben wir unsere Organisationsstruktur vereinfacht mit dem Ziel, kürzere und schnellere Entscheidungswege innerhalb der gesamten Gesellschaft zu schaffen sowie eine größere Kundenorientierung, höhere Effizienz und Flexibilität zu erzielen. Wir haben auch bestimmte zentrale Funktionen, zum Beispiel den Verkauf und die Produktion, in die operativen Segmente integriert. Darüber hinaus haben wir Meilensteine bei unseren produzierenden Gemeinschaftsunternehmen und bei der Entwicklung neuer Produkttechnologien erreicht. Wesentliche Entwicklungen im Geschäftsjahr 2005 waren:

- ... Der Geschäftsbereich Mobile und das Segment Drahtgebundene Kommunikation wurden in dem neuen Segment Kommunikation gebündelt, um unsere Unternehmensstruktur an die Marktentwicklung anzupassen. Gleichzeitig wurden die Sicherheits- und Chipkarten-Aktivitäten sowie die Sparte ASIC & Design Solutions in das erweiterte Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarkt eingegliedert.
- ... Die Umsatzerlöse verringerten sich von 7.195 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2004 um 6,1 Prozent auf 6.759 Millionen Euro. Unser Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging von einem positiven Ebit von 256 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2004 auf ein negatives Ebit von 183 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2005 zurück.
- ... Im Geschäftsjahr 2005 verringerte sich unser Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von 1.857 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2004 auf 1.039 Millionen Euro. Dies beruht vor allem auf einem niedrigeren Bruttoergebnis vom Umsatz und der Veränderung von verschiedenen kurzfristigen Verbindlichkeiten.
- ... Wir haben mit der ProMOS Technologies Inc. („ProMOS“) eine Vereinbarung über die Lizenzvergabe von früher an ProMOS transferierten Technologien abgeschlossen. ProMOS darf Produkte auf Basis dieser Technologien herstellen und vertreiben sowie darauf basierende eigene Prozesse und Produkte entwickeln. Als Gegenleistung erhalten wir einen Betrag von 156 Millionen US-Dollar, der in vier Raten bis zum 30. April 2006 zu zahlen ist. Die Parteien haben die in

diesem Zusammenhang stehenden Klagen zurückgezogen.

- ... Wir haben den verbleibenden 30-prozentigen Anteil von Saifun Semiconductors Ltd. („Saifun“) an dem Infineon Technologies Flash Joint Venture übernommen. Als Teil dieser Akquisition erhält die Gesellschaft eine Lizenz für die Nutzung der NROM®-Technologie von Saifun.
- ... Wir veräußerten bestimmte Vermögensgegenstände unseres Glasfaserkomponentengeschäfts an die Finisar Corporation („Finisar“) und erhielten als Gegenleistung 34 Millionen Finisar-Aktien, die wir anschließend verkauft haben.
- ... Wir veräußerten die Infineon Venture GmbH, die den Großteil der Wagniskapitalbeteiligungen der Gesellschaft beinhalten.
- ... Wir haben mit der Rambus Inc. („Rambus“) eine Übereinkunft getroffen, wonach auf sämtliche gegenseitige Ansprüche verzichtet wird und wir das Patentportfolio von Rambus weltweit für unsere bestehenden und zukünftigen Produkte nutzen können.
- ... Wir haben weitere Maßnahmen zur Kostensenkung beschlossen, die einen Abbau der Mitarbeiterzahl sowie die Zusammenfassung bestimmter Funktionen und Geschäfte beinhalten. Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen fielen im Geschäftsjahr 2005 Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 78 Millionen Euro an.
- ... Im Geschäftsjahr 2005 haben wir Wertberichtigungen auf Vermögensgegenstände in Höhe von 134 Millionen Euro vorgenommen, im Wesentlichen im Zusammenhang mit unserem verbliebenen Glasfaserkomponentengeschäft, der Reorganisation innerhalb des Segments Kommunikation sowie unseren Finanzanlagen.
- ... Wir haben weiterhin massiv in Forschung und Entwicklung investiert. Bedeutende Erfolge, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu verzeichnen waren, sind die Einführung von:
 - ... E-GOLDradio, dem neuesten Mitglied unserer erfolgreichen E-GOLD-Familie, das die vollständige Funktionalität unseres Basisbandprozessors, E-GOLDLITE, und des hoch entwickelten RF Transceiver, SMARTI SD2, vereint;
 - ... 90-Nanometer-DRAM-Trench-Technologie und Demonstration von ersten funktionierenden Halbleitern auf Basis der 70-Nanometer-DRAM-Trench-Technologie;
 - ... VINAX, unsere neue VDSL2-Chiplösung, konstruiert für Anwendungen im Bereich der Low-End-Modems bis hin zu High-End-Home-Gateways;
 - ... SMARTI 3G, das neueste Mitglied unserer erfolgreichen UMTS-Transceiver-Familie, konstruiert für

- mobile Anwendungen, das alle derzeitigen sechs UMTS-Frequenzen weltweit unterstützt;
- ... neuen 8-, 16-, 32-Bit-Mikrocontrollern mit integriertem Flash für Anwendungen im Industrie- und Automobilbereich;
- ... der neuen komprimierten Produktionsmethode FCOS (Flip Chip On Substrate), gemeinschaftlich entwickelt mit Giesecke & Devrient GmbH („Giesecke & Devrient“); und
- ... Trusted-Platform-Modul (TPM), eine vollständig unabhängige Hard- und Software-Lösung, die den Spezifikationen der Trusted-Computing-Group entspricht.
- ... Erfolge im Rahmen unserer fortlaufenden Bemühungen, Produktionsprozesse zu verbessern und unsere Produktionsleistungsfähigkeit zu erhöhen, sind:
 - ... Erfolgreicher Transfer unserer leistungsfähigen Prozesstechnologie für die Herstellung von Logikchip-Produkten auf der Basis von 130-Nanometer-Strukturen an verschiedene Fertigungsstätten zur Erhöhung unserer Produktionsflexibilität.
 - ... Im Bereich der Speicher-Prozesstechnologien haben wir erfolgreich die 90-Nanometer-Prozesstechnologie für DRAM-Produkte in unserer 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Dresden eingeführt.
 - ... Erweiterung der gemeinsamen Kooperation mit Nanya Technology Corporation („Nanya“) zur Entwicklung der nächsten Generation 60-Nanometer-DRAM-Trench-Technologie.
 - ... Unser Gemeinschaftsunternehmen Inotera Memories Inc., Taoyuan, Taiwan („Inotera“), hat ein Produktionsvolumen von 60.000 Waferstarts pro Monat mehrere Monate vor dem Zeitplan erreicht.
 - ... Unsere 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Richmond/Virginia, USA, und unser Produktionspartner Semiconductor Manufacturing International Corporation („SMIC“) in Peking, China, haben mit der kommerziellen Produktion begonnen.
 - ... Beginn der Produktion in unserer Fertigungsstätte für Montage und Prüfung von Speicherprodukten in Suzhou, China.
 - ... Beginn des Aufbaus einer Front-End-Fabrik im Kulim High Tech Park, Kulim, Malaysia, mit einem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von zirka 1 Milliarde US-Dollar. Die Fabrik wird hauptsächlich Power- und Logikchips für Automobil- und Industrieanwendungen produzieren.
 - ... Eröffnung eines neuen Entwicklungszentrums in Bukarest, Rumänien, mit dem Schwerpunkt auf Power-ICs einschließlich analoger und digitaler Funktionen.

UNSER GESCHÄFT

Wir entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen. Diese werden in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen eingesetzt, wie Computersystemen, Telekommunikationssystemen, Konsumgütern, Produkten der Automobilindustrie und der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie Chipkarten. Unser Produktspektrum umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen sowie spezifische Bauelemente für Speicher-, Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Unsere Fertigungsstätten, Beteiligungen und Kunden befinden sich hauptsächlich in Europa, Asien und Nordamerika.

Nach unserer internen Reorganisation im Geschäftsjahr 2005 ist unser Geschäft nun schwerpunktmäßig in drei operative Segmente gegliedert, die auf einer Reihe von Märkten in der Halbleiterbranche tätig sind:

- ... Unser Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte sowie Systemlösungen für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Industrieelektronik und im Multimarket-Bereich.
- ... Unser Segment Kommunikation entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt eine große Bandbreite von ICs, anderen Halbleiterprodukten sowie kompletten Systemlösungen für drahtlose und drahtgebundene Kommunikationsanwendungen.
- ... Unser Segment Speicherprodukte entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterspeicherprodukte in verschiedenen Konfigurationen und Gehäusen sowie mit verschiedenen Leistungsparametern für standardisierte, spezielle und eingebettete Speicheranwendungen.

Für Zwecke der Berichterstattung führen wir zwei weitere Segmente auf: Das Segment Sonstige Geschäftsbereiche umfasst verbleibende Aktivitäten von veräußerten Geschäften wie auch andere Geschäftsaktivitäten. Das Segment Konzernfunktionen erfasst die Positionen, die nicht den anderen Segmenten zugerechnet werden können, wie bestimmte Kosten der Konzernzentrale, strategische Investitionen, nicht verrechnete Leerkosten, Restrukturierungskosten und zentrale IT-Entwicklungskosten.

DARSTELLUNG DER HALBLEITERINDUSTRIE UND DER FAKTOREN MIT EINFLUSS AUF UNSER GESCHÄFT

Unser Geschäft und die Halbleiterindustrie sind durch eine hohe Zyklicität gekennzeichnet. Charakteristisch sind konstante und rapide technologische Veränderungen,

schnelle Produktveralterung und Preiserosion, die kontinuierliche Entstehung neuer Standards, kurze Produktlebenszyklen und starke Schwankungen bei Produktangebot und -nachfrage. Obwohl diese Faktoren alle Segmente unseres Geschäfts beeinflussen, treffen sie in besonderem Maße auf das Segment Speicherprodukte und zunehmend auch auf das Segment Kommunikation zu. Den geringsten Einfluss haben diese Faktoren auf das Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multi-market.

Zyklizität

Die Zyklizität in der Halbleiterindustrie beruht auf einem komplexen Zusammenspiel von Faktoren, insbesondere der fluktuierenden Nachfrage nach Endprodukten, die Halbleiter enthalten, und Schwankungen in der zur Verfügung stehenden Kapazität zur Herstellung von Halbleitern. Diese Zyklizität ist im Bereich der Speicherprodukte besonders stark ausgeprägt. Weil sich Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme von Halbleiterfertigungsstätten über mehrere Jahre hinziehen können, neigen Halbleiterhersteller zu Investitionen in Zeiten günstiger Marktbedingungen, um so auf mögliche zukünftige Nachfrageresteigerungen zu reagieren. Wenn mehr als eine der neu errichteten Fertigungsstätten ihren Betrieb innerhalb desselben Zeitfensters aufnehmen, kann das Angebot an Chips auf dem Markt beträchtlich ausgeweitet werden. Ohne anhaltendes Nachfragewachstum führt dieses Verhalten typischerweise zu Überkapazitäten in der Produktion und einem Überangebot an Produkten und in der Folge zu einschneidenden Preiseinbrüchen für Halbleiterprodukte. Fallen die Preise, reduzierten die Hersteller in der Vergangenheit die Investitionen in neue Fertigungsstätten. Da aber zurzeit die Nachfrage nach Chips wieder zunimmt, steigen die Preise ohne Inbetriebnahme zusätzlicher Fertigungsstätten, was zu einem neuen Investitionszyklus führt. Die Halbleiterindustrie reagiert auf einen Nachfragerückgang üblicherweise träge, da sie kapitalintensiver ist und Entscheidungen über den Zukauf von Produktionsanlagen weit vor einer geplanten Expansion zu treffen sind.

Wir sind bestrebt, den Einfluss der Zyklizität im Segment der Speicherprodukte mit Hilfe von kontinuierlichen Investitionen in Fertigungskapazitäten über den gesamten Zyklus, von Kooperationsvereinbarungen und Auftragsfertigungsabkommen zu mindern, damit wir auf Zyklusänderungen flexibler reagieren zu können. Wir sind der Überzeugung, dass wir unser Bruttoergebnis vom Umsatz im Segment Speicherprodukte durch die Fokussierung unserer Investitionen auf zwei Kerngebiete verbessern können: die kontinuierliche Verbesserung der Kostenstruktur und der Produktivität durch

Einführung fortschrittlicher Speicherprozesstechnologien sowie die Entwicklung und Vermarktung einer diversifizierteren Produktpalette, die sich im Besonderen auf höhere Margen und weniger volatile Anwendungen wie Infrastruktur, hoch auflösende grafische und mobile Anwendungen sowie Anwendungen für Konsumenten fokussiert.

Saisonabhängigkeit

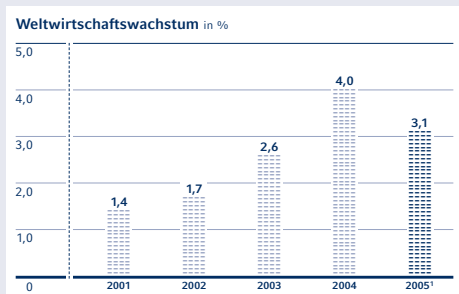
Das umsatzstärkste Quartal ist erfahrungsgemäß das vierte Quartal des Geschäftsjahrs, umsatzschwächer sind das erste und das zweite Quartal. In der Saisonabhängigkeit unserer Verkäufe wird die saisonale Nachfrage nach Produkten, die unsere Halbleiter verwenden, widerspiegelt. Wenn antizipierte Umsätze und Lieferungen nicht wie erwartet stattfinden, können in einem solchen Quartal überproportional hohe Ausgaben und Lagerbestände auftreten, was das Ergebnis des Quartals und möglicherweise das Ergebnis der folgenden Quartale negativ beeinflussen kann.

Produktentwicklungszyklen

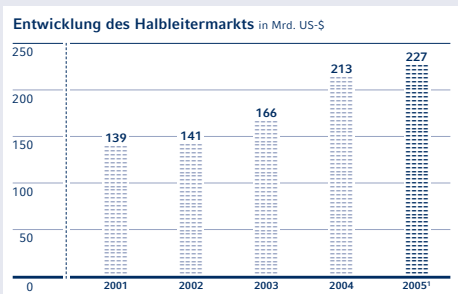
Bei Logikprodukten kann sich die Zeitspanne vom Test über die Evaluierung und Kundenakzeptanz bis hin zur Serienfertigung über mehrere Monate bis mehr als ein Jahr hinziehen. Wegen der Länge dieses Zyklus kann es zu signifikanten zeitlichen Verzögerungen zwischen den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, Marketingaktivitäten und dem Aufbau von Vorräten bis zur Einnahme der entsprechenden Erlöse kommen. Speicherprodukte werden auf Grund der größeren Standardisierung der Speicherprodukte von Entwicklungszyklen weniger beeinflusst.

HERAUSFORDERUNGEN IN DER ZUKUNFT

Unser künftiger Erfolg wird vor allem von unserer Fähigkeit abhängen, weiterhin Spitzentechnologien zu entwickeln und unser Produktportfolio zu optimieren. Wir müssen beide Ziele erreichen, um der fluktuierenden Nachfrage nach verschiedenen Halbleiterprodukten zu begegnen. Wir sind der Überzeugung, dass die Fähigkeit, ein breites Portfolio anzubieten und flexibel zu fertigen, in zunehmendem Maße zu unserem langfristigen Erfolg auf vielen Märkten in der Halbleiterindustrie beitragen wird. Die Entwicklung und Erhaltung eines Technologievorsprungs, Entwicklungs- und Fertigungsallianzen, einschließlich der Auftragsfertigung durch Dritte, sowie beständige Bemühungen zur Portfolio-Diversifikation werden die Reaktion auf veränderte Marktbedingungen erleichtern und unsere finanzielle Ertragskraft stärken.



Das abgeschwächte Weltwirtschaftswachstum im Kalenderjahr 2005 gibt dem Halbleitermarkt keine deutlichen Wachstumsimpulse.
Quelle: Internationaler Währungsfonds; Stand: September 2005.
1 Geschätzt.



Abgeschwächtes Wachstum des Halbleitermarkts im Kalenderjahr 2005 beeinflusste auch die Infineon-Geschäfte negativ.
Quelle: WSTS; Stand: Oktober 2005.
1 Geschätzt.

DARSTELLUNG DES HALBLEITERMARKTS IM GESCHÄFTSJAHR 2005

Im Kalenderjahr 2005 hat sich das Wachstum des Halbleitermarkts deutlich abgeschwächt. Nachdem der Halbleitermarkt im Kalenderjahr 2004 entsprechend World Semiconductor Trade Statistics („WSTS“) um 28 Prozent gewachsen war, erwartete WSTS im Oktober 2005 für das Kalenderjahr 2005 ein Wachstum von 7 Prozent. Seinen Umsatz weiter ausweiten wird laut WSTS der asiatisch-pazifische Raum mit einem prognostizierten Wachstum von 16 Prozent im Kalenderjahr 2005. Für den japanischen Markt wird ein leichter Rückgang von minus 3 Prozent erwartet, Europa wird nach dieser Prognose stagnieren, Amerika mit 2 Prozent leicht wachsen. Der Bereich der Nicht-Speicher-Produkte (Logikchips, analoge, diskrete und optische Komponenten), der 79 Prozent des Gesamtmarkts im ersten Kalenderhalbjahr 2005 ausmachte, soll gegenüber dem Kalenderjahr 2004 um 8 Prozent wachsen. Für den Bereich der Speicherprodukte wird im Vergleich zum Kalenderjahr 2004 eine Wachstumsrate von 3 Prozent prognostiziert.

Für das Kalenderjahr 2005 sieht das Marktforschungsinstitut Gartner Dataquest ein weltweites Marktwachstum von 5 Prozent bei Halbleitern im Bereich der Kommunikation (drahtlose und drahtgebundene Kommunikation). Im Bereich Halbleiter für Datenverarbeitung werden 7 Prozent, für Konsumelektronik 12 Prozent und für die Automobilelektronik 7 Prozent Wachstum angenommen.

PLÄNE FÜR EINE NEUE AUSRICHTUNG DER GESELLSCHAFT

Unser Hauptziel ist, profitables Wachstum zu erreichen und den Nutzen für unsere Gesellschafter zu maximieren. Dementsprechend prüfen wir regelmäßig zweckmäßige Schritte zur Erreichung dieser Ziele. Nach umfangreicher

Analyse unserer Märkte und Geschäfte sowie im Hinblick auf die Förderung der genannten Ziele hat der Aufsichtsrat im November 2005 dem Vorhaben zugestimmt, unsere Gesellschaft neu auszurichten um uns darauf vorzubereiten, die Marktchancen im Speicher- und Logik-Geschäft besser auszuschöpfen, sofern und sobald sie eintreten.

Der erste Schritt in diesem Prozess wird die Übertragung aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten unseres Segments Speicherprodukte auf eine eigenständige und vollständig von Infineon gehaltene Tochtergesellschaft sein (gemäß deutschem Recht ist diese Übertragung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten oder einem Teilbetrieb als Ausgliederung bekannt).

Wir glauben, dass diese organisatorischen Maßnahmen uns schnell in die Lage versetzen werden, Vorteile aus den entsprechenden Marktchancen für das Speicher-geschäft zu ziehen, sofern und sobald sie eintreten. Wir beabsichtigen, die finanziellen und industriellen Entwicklungen kontinuierlich während des Geschäftsjahrs 2006 zu überwachen und zu bewerten sowie weitere Re-organisations-schritte, soweit zweckmäßig, in Betracht zu ziehen. Unser Vorstand bevorzugt die Alternative, die Marktposition der Speicherproduktgruppe durch einen Börsengang der neuen Tochtergesellschaft zu verstärken. Nichtsdestoweniger haben wir über spezifische Schritte oder den zeitlichen Rahmen solcher Schritte noch nicht entschieden. Mittel- bis langfristig gesehen würden wir auch eine Reduzierung unserer Position im Speichersegment auf einen Minderheitsanteil in Betracht ziehen.

Hintergrund

Unser Geschäft schließt sowohl die Speicheraktivitäten unseres Segments Speicherprodukte als auch die Logik-

aktivitäten unserer zwei anwendungsorientierten Segmente – Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket sowie Kommunikation – ein. Sowohl der Speicher- als auch der Logikbereich unseres Geschäfts haben historisch von bestimmten Synergien profitiert. Allerdings glauben wir, dass sich die beiden Geschäfte, was wesentliche Erfolgsfaktoren betrifft, auseinander bewegen. Dies spiegelt die Unterschiede in der technologischen Innovation und der wirtschaftlichen Entwicklung wider. Die Synergien werden daher sinken. Insbesondere das Speichergeschäft bleibt weiter durch den hohen Kapitalbedarf zur Erneuerung der Fertigungsprozesse und Verbesserung der Kostenposition gekennzeichnet. Hingegen entwickelt sich das Logikgeschäft zu einem anwendungs- beziehungsweise lösungsgeprägten Bereich, der eine kontinuierliche Produktentwicklung und spezialisierte Fertigung benötigt. Der intensive Kapitalbedarf im Speichergeschäft spiegelt die Notwendigkeit von kontinuierlichen Investitionen in aufwändige, effiziente und neueste Fertigungsstätten und Spitzenfertigungstechnologien wider. Der Einfluss der Fertigung ist im Logikgeschäft geringer. Bestimmte Bereiche des Logikgeschäfts (unser „advanced logic business“ besteht im Wesentlichen aus Basisband-ICs für Mobiltelefone und einer Angebotspalette aus Chipkarten, drahtgebundene Kommunikation, Mikrocontrollern sowie anderen kundenspezifischen ICs) sind gut darauf vorbereitet, die Produktionskapazität von Anbietern standardisierter Fertigungsprozesse für Halbleiter zu nutzen (die so genannte CMOS-Technologie). Bestimmte andere Bereiche des Logikgeschäfts, im Wesentlichen unser Power- und RF-IC-Geschäft, können sich auf hoch entwickelte, erheblich weniger kapitalintensive Fertigungsprozesse stützen,

die firmenintern beherrscht werden und ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb sind. Darüber hinaus wird von den eingesetzten Technologien in den beiden Geschäften erwartet, dass sie sich weiter auseinander entwickeln. Dies resultiert unter anderem aus den unterschiedlichen Entwicklungspfaden – wobei sich der Speicherbereich überproportional stark auf die Prozesstechnologie konzentriert – und dem Erfordernis von Strategie- und Entwicklungsallianzen mit unterschiedlichen Partnern. Die Synergien hinsichtlich Konstruktionsmethoden und -geräten werden sehr eingeschränkt sein. Schlussendlich unterliegen die zwei Geschäftsbereiche einer sehr unterschiedlichen Finanzmarktdynamik, die für Investoren in einem zusammengefassten Geschäft weniger transparent sein könnten.

ENTWICKLUNG DER ERTRAGSLAGE

Reorganisation

Bis zum Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahrs 2005 war die Gesellschaft in vier Hauptsegmenten organisiert, davon waren drei Segmente anwendungsorientiert – Drahtgebundene Kommunikation, Sichere Mobile Lösungen und Automobil- und Industrieelektronik – und ein Segment produktorientiert – Speicherprodukte. Mit Wirkung zum 1. Januar 2005 haben wir unsere Organisationsstruktur vereinfacht und schaffen damit im gesamten Unternehmen kürzere und schnellere Entscheidungswege, eine stärkere Ausrichtung auf unsere Kunden und eine höhere Effizienz und Flexibilität. Der Geschäftsbereich Mobile und das Segment Drahtgebundene Kommunikation wurden in dem neuen Seg-

Positionen der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung in % vom Umsatz

Geschäftsjahr zum 30. September ¹	2003	2004	2005
Umsatzerlöse	100,0	100,0	100,0
Umsatzkosten	-75,0	-64,9	-72,6
Bruttoergebnis vom Umsatz	25,0	35,1	27,4
Forschungs- und Entwicklungskosten	-17,7	-16,9	-19,1
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-11,0	-10,0	-9,7
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	-0,5	-0,2	-1,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen, Saldo	-1,4	-3,6	-1,4
Betriebsergebnis	-5,6	4,4	-4,0
Zinsergebnis	-0,8	-0,6	-0,1
Anteiliger Jahresüberschuss/-fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	0,3	-0,2	0,9
Erträge/Aufwendungen aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	-0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo	0,3	-0,9	0,4
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	0,1	0,3	0,0
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,7	3,0	-2,8
Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,4	-2,1	-1,8
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	-7,1	0,9	-4,6

¹ Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.

ment Kommunikation gebündelt, um die Struktur der Gesellschaft entsprechend der Entwicklung im Markt anzupassen. Gleichzeitig haben wir das Sicherheits- und Chipkartengeschäft und das ASIC & Design-Solutions-Geschäft in das erweiterte Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket eingegliedert.

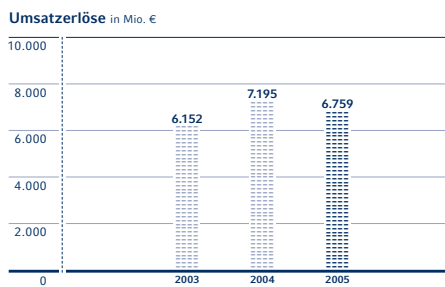
Somit ist die Gesellschaft in drei Hauptsegmenten organisiert, davon sind zwei Segmente anwendungsorientiert – Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket und Kommunikation – und ein Segment produktorientiert – Speicherprodukte. Diese Segmente entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen, die in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen eingesetzt werden.

Die Gesellschaft berichtet ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 unter der neuen Organisationsstruktur. Die Ergebnisse von früheren Berichtszeiträumen wurden entsprechend umgestellt, um einen Vergleich zum aktuellen Zeitraum zu ermöglichen.

Umsatzerlöse

Wir generieren Erlöse im Wesentlichen aus dem Verkauf von Halbleiterprodukten und Systemlösungen. Zusätzliche Erlöse von weniger als 4 Prozent unserer Umsätze generieren wir mit Hilfe von Aktivitäten wie der Auftragsfertigung für verkaufte Geschäfte und Lizenzvergaben auf unser geistiges Eigentum. Unsere Halbleiterprodukte gliedern sich in zwei Hauptkategorien:

- ... Die Palette unserer Logikchip-Produkte wie Chips und Komponenten findet breite Anwendung in elektronischen Geräten zur drahtlosen Kommunikation (Mobilfunk und Bluetooth-Datenübertragung), Chipkarten, Modems und anderen drahtgebundenen Technologien wie DSL, Automobilelektronik und Industrietechnik.
- ... Die Palette unserer Speicherprodukte umfasst Dynamic-Random-Access-Memory (DRAM)-Chips für Computer und andere elektronische Geräte. Wir bieten außerdem eine begrenzte Palette nicht-flüchtiger Flash-Speicherprodukte an, die in der Konsumelektronik in Digitalkameras oder bei Mobiltelefonen Anwendung finden.



Starker Preisdruck in allen Segmenten lässt die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2005 zurückgehen.

Der Großteil der Verkäufe erfolgt über unseren direkten Vertrieb. Ungefähr 14 Prozent des Gesamtumsatzes wurden in den genannten Perioden über Distributoren getätigt.

Wir erzielen unsere Einkünfte aus Lizenzen über Stück- und Pauschalgebühren, indem wir an Dritte Lizenzen auf Technologien vergeben, deren Eigentümer wir sind. So können wir einen Teil unserer Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen abdecken und erlangen oft gleichzeitig über Lizenzierungs- und Kapazitätsreservierungs-Vereinbarungen Zugang zu zusätzlichen Fertigungskapazitäten bei Auftragsherstellern. Wir erzielen die Lizenzentnahmen hauptsächlich im Segment Speicherprodukte. Diese entstanden durch Technologietransfer an unsere derzeitigen und ehemaligen Kooperationspartner wie Winbond, Nanya und ProMOS.

Unsere Umsatzerlöse schwanken auf Grund von verschiedenen Faktoren, unter anderen:

- ... Marktpreisen für unsere Produkte, insbesondere bei Speicherprodukten,
- ... unserem gesamten Produkt-Mix und unserem Verkaufsvolumen,
- ... der Phase im Lebenszyklus unserer Produkte sowie
- ... Wettbewerbseffekten und konkurrenzfähigen Preisstrategien.

Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
Umsatzerlöse	6.152	7.195	6.759
Prozentuale jährliche Veränderung		17 %	-6 %
darin enthalten:			
Einkünfte aus Lizenzvergaben in Mio. €	183	76	175
Prozent des Umsatzes	3 %	1 %	3 %
Fremdwährungseffekte im Vergleich zum Vorjahr in Mio. €	-317	-445	-177
Prozent des Umsatzes	-5 %	-6 %	-3 %
Auswirkungen von Akquisitionen im Vergleich zum Vorjahr in Mio. €	126	29	2
Prozent des Umsatzes	2 %	0 %	0 %

Die Zunahme der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2004 war größtenteils von einer gesteigerten Nachfrage nach Speicherprodukten und Chips für Mobiltelefone und der weiterhin starken Entwicklung unseres Segments Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket getrieben. Im Geschäftsjahr 2005 sanken die Umsatzerlöse im Wesentlichen auf Grund der schwächeren Nachfrage nach Produkten im drahtlosen Bereich und wegen des Preisrückgangs bei Speicherprodukten. Die Lizenzeeinnahmen sanken im Geschäftsjahr 2004 vor allem als Resultat reduzierter Lizenzeeinnahmen mit ProMOS. Im Geschäftsjahr 2005 erhöhten sich die Lizenzeeinnahmen als Folge einer mit ProMOS erreichten Einigung, wobei 118 Millionen Euro als Lizenzeeinnahmen vereinnahmt wurden. Zusätzlich wurde der Umsatz durch die Schwäche der wichtigsten Fremdwährungen in Relation zum Euro (vorwiegend des US-Dollars) während der Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 negativ beeinflusst. Der Fremdwährungseffekt im Vergleich zum Vorjahr wird ermittelt, indem der durchschnittliche Wechselkurs des vergangenen Jahrs als konstanter Wechselkurs auf die Umsatzerlöse des aktuellen Jahrs angewendet wird. Der Anstieg der Umsatzerlöse aus zugekauften Aktivitäten seit Beginn des vergangenen Jahrs spiegelt vorwiegend die ganzjährige Konsolidierung der Umsätze im Jahr nach der Akquisition wider.

Umsatzerlöse nach Segmenten

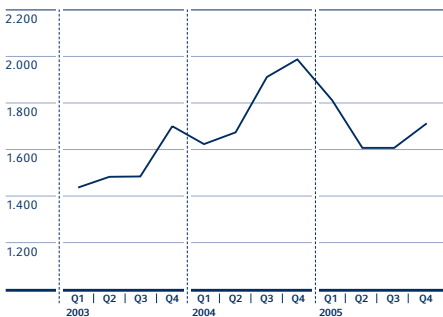
--- Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

Das Segment setzte die Wachstumsphase im Geschäftsjahr 2004 fort, vor allem durch den Absatz von Automobilanwendungen. Dies resultierte aus einem steigenden Einsatz von Halbleitern in der Automobilelektronik, der stärker als der anhaltende Preisdruck durch technischen Fortschritt und Wettbewerb war. Die Umsatzsteigerung war überwiegend auch auf einen Volumenanstieg der Automobil- und Industrieprodukte und auf gestiegene Nachfrage nach Chipkarten und Sicherheitsprodukten zurückzuführen. Im Markt für Chipkarten-ICs waren wir im Geschäftsjahr 2003 einem anhaltenden Preisdruck ausgesetzt. Im Geschäftsjahr 2004 profitierte der Umsatz von einem geringeren Preisrückgang. Der Umsatz profitierte zudem von der ganzjährigen Konsolidierung von SensoNor AS („SensoNor“), die im Juni 2003 erworben worden war, und vom steigenden Absatz von Industrieapplikationen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004. Im Geschäftsjahr 2005 gingen die Umsätze in diesem Segment im Vergleich zum Geschäftsjahr 2004 leicht zurück, wobei sich das Wachstum mit Automobilanwendungen fortsetzte. Der Umsatzrückgang ist vorwiegend auf starken Preisdruck, kombiniert mit sinkenden Marktvolumina im Geschäft mit Sicherheits- und Chipkarten-ICs zurückzuführen.

--- Kommunikation

Im Geschäftsjahr 2003 und in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004 erlebten wir eine steigende Nachfrage nach digitalen Zugangsprodukten, da der Bedarf an DSL-Internetbasierter Kommunikation stieg und sich die Situation der Märkte in den Entwicklungsländern verbesserte. Ein gegenläufiger Trend war der Nachfragerückgang bei traditionellen analogen Kommunikationsprodukten, der in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004 stärker ausgeprägt war als in den vorhergehenden Perioden. Das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2004 lag vorwiegend im zweiten Halbjahr, da die Nachfrage nach mobilen Lösungen anzog. Im Jahresvergleich sank der Absatz im Geschäftsjahr 2005 im Segment Kommunikation aufgrund sinkender Umsätze im Geschäft für drahtlose Kommunikation. Die Ursachen sind sowohl ein Nachfragerückgang bei bestimmten Kunden

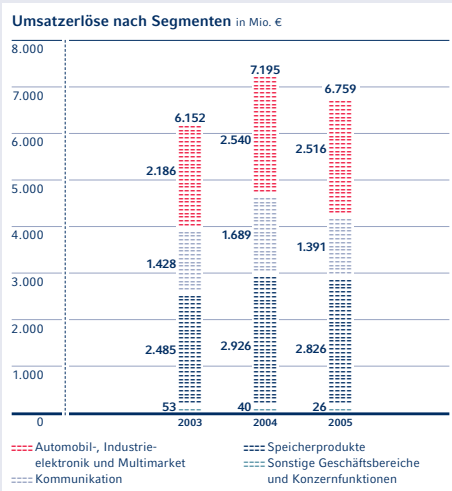
Umsatz nach Quartalen in Mio. €



Höhere Volumen lassen die Umsatzerlöse im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 wieder ansteigen.

Geschäftsjahr zum 30. September

	2003		2004		2005	
	in Mio. €	%	in Mio. €	%	in Mio. €	%
Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket	2.186	36	2.540	35	2.516	37
Kommunikation	1.428	23	1.689	24	1.391	21
Speicherprodukte	2.485	40	2.926	41	2.826	42
Sonstige Geschäftsbereiche	21	-	11	-	12	-
Konzernfunktionen	32	1	29	-	14	-
Summe Umsatzerlöse	6.152	100	7.195	100	6.759	100

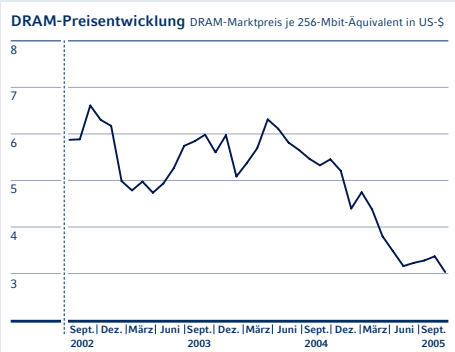


Neben dem Preisdruck beeinflusste der Nachfragerückgang bei drahtloser Kommunikation die Umsatzerlöse in den Segmenten erheblich.

von Basisband-Komponenten, beginnend mit dem zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005, als auch der anhaltende Preisdruck. Dieser Rückgang konnte durch den stabilen Absatz drahtgebundener Produkte nicht ausgeglichen werden.

--- Speicherprodukte

Die Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2004 resultiert hauptsächlich aus einem höheren Verkaufsvolumen, was den ungünstigen Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar und die geringeren Lizenzentnahmen im Vergleich zum vorhergehenden Jahr mehr als ausgleichen konnte. Der Absatz wurde weiterhin von dem Produktionshochlauf der 300-Millimeter-Fertigung in Dresden, der Umstellung auf 110-Nanometer-Technologie und der zusätzlichen Kapazität aus der Kooperation mit Winbond und SMIC begünstigt, was den Rückgang der von PROMOS gekauften Produkte kompensierte. Das Absatzvolumen in Megabit erhöhte sich im Laufe des Geschäftsjahrs 2004 durch die gestiegene Nachfrage nach PCs und Datenspeichern. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2005 sank verglichen zum Vorjahr. Dies lag insbesondere an dem Preisdruck in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs, der nicht durch gestiegene Bit-Kapazität pro Chip und gestiegene Umsätze aus Lizenzen und bei Flash-Speicherprodukten kompensiert werden konnte. Zusätzlich erschwerend wirkte sich ein ungünstiger Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar aus. Die Produktionsvolumina stiegen im Geschäftsjahr 2005, da das Gemein-



Quelle: WSTS

schaftsunternehmen Inotera hochgefahren wurde und Zugang zu zusätzlicher Kapazität durch unsere Kooperation mit Winbond und SMIC geschaffen wurden. Generell wurde der Megabit-Absatz im Geschäftsjahr 2005 gesteigert. Ursachen waren gestiegene Marktnachfrage unter anderem bei PCs und Datenspeichern. Die Mehrheit der Umsätze mit Speicherprodukten war im ersten Halbjahr 2005 auf die 256-Megabit-DRAM zurückzuführen und im zweiten Halbjahr 2005 auf die 512-Megabit-DRAM, da sich der Markt zur nächsten Produktgeneration mit höherer Speicherdichte verlagerte.

Im Geschäftsjahr 2005 fielen die Preise in US-Dollar beider Hauptprodukte, DDR- und DDR2-Speicherbausteine, insbesondere während der saisonal schwächeren Phase zwischen Januar und April, drastisch. Ab April stabilisierten sich die DDR-Preise wieder, während die DDR2-Preise, vorwiegend wegen Angebotsüberschuss und eines langsamer als erwarteten Wechsels hin zu DDR2 als führendem Speicherstandard, weiter unter Druck blieben. Vertrags- und Spotmarktpreise folgten einem ähnlichen Trend. Die Preise pro Bit für SDRAM-Produkte kleinerer Speicherdichte fielen während des Geschäftsjahrs ebenfalls. Verglichen mit DDR und DDR2 verblieben die Preise allerdings auf höherem Niveau auf Grund ihres etablierten Charakters. Wir sind weiterhin bestrebt, unser Produktangebot auszuweiten und unseren Produkt-Mix zu optimieren, um Preisdifferenzen ausgleichen zu können. Des Weiteren versuchen wir, uns verstärkt auf Produkte zu fokussieren, von denen wir erwarten, dass sie eine geringere Volatilität und höhere Margen aufweisen. Dazu zählen Produkte für Server, Konsumenten, hoch auflösende grafische und mobile Anwendungen. Unsere durchschnittlichen Megabit-Verkaufspreise sanken im Geschäftsjahr 2005 um zirka 27 Prozent.

--- Sonstige Geschäftsbereiche

Im Geschäftsjahr 2005 blieben die Umsatzerlöse relativ stabil.

Umsatzerlöse nach Regionen und Kunden

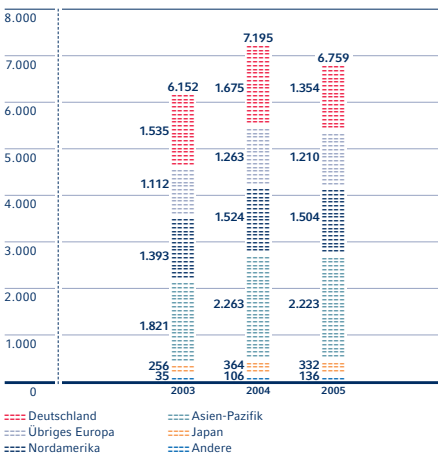
Im Geschäftsjahr 2005 sind unsere Umsatzerlöse in allen Regionen zurückgegangen. Dies ist vor allem eine Folge des Preisdrucks und einer geringeren Nachfrage nach Halbleiterprodukten, insbesondere nach Basisband-Komponenten im drahtlosen Geschäft in Deutschland.

Im Segment Kommunikation haben wir eine weitere Konsolidierung in der Industrie gesehen. Im Geschäftsjahr 2005 haben die größten Hersteller von Mobiltelefon Endgeräten Marktanteile zu Lasten anderer Wettbewerber gewonnen. Von der Übernahme der Siemens-Mobilfunksparte durch den taiwanesischen Konzern BenQ Corporation („BenQ“) erwarten wir uns, dass ein Teil

des Produktvolumens eines unserer größten Kunden für Mobiltelefonplattformen wegen der geringeren Herstellungskosten in Asien und den Schwellenländern derthin transferiert wird. Die Anzahl unserer Kunden im Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket blieb stabil. Im Geschäftsjahr 2005 haben wir mit unseren 20 größten Kunden nahezu 60 Prozent unserer Umsätze in diesem Segment erwirtschaftet. Das Geschäftsjahr 2005 brachte im Zusammenhang mit einer Verlagerung der Produktionsstätten unserer Kunden von Deutschland in andere europäische Staaten, im Wesentlichen nach Osteuropa, eine Verlagerung unserer Umsatzerlöse in diese Länder. Die Anzahl der Kunden im Segment Speicherprodukte erhöhte sich auf Grund der Diversifikation unseres Produktportfolios. Demgegenüber verringerte sich die Kundendichte als Folge der Erhöhung der Kundenanzahl im Speicherbereich. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschafteten wir mit unseren 20 größten Kunden nahezu 80 Prozent der Umsätze in diesem Segment.

Auf den Siemens-Konzern entfielen in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 14 Prozent, 13 Prozent und 13 Prozent unserer Umsatzerlöse. Der Umsatz mit Siemens beinhaltet sowohl Direktverkäufe an den Siemens-Konzern in Höhe von 13 Prozent, 13 Prozent und 12 Prozent für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 als auch Verkäufe an die Siemens-Vertriebsorganisationen zum Weiterverkauf an Drittkunden in Höhe von 1 Prozent, 0 Prozent und 1 Prozent in den Jahren 2003, 2004 und 2005. Die Umsätze mit dem Siemens-Konzern werden hauptsächlich in den Nicht-Speicher-Segmenten getätigt. Auf keinen anderen Kunden entfielen 10 Prozent oder mehr unserer Umsatzerlöse in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2005 wurde die Siemens-Mobilfunksparte an den taiwanesischen Konzern BenQ verkauft. Wir nehmen zwar an, dass Siemens einer unserer größten Kunden im Geschäftsjahr 2006 bleiben wird, erwarten aber, dass sich auf Grund des Verkaufs dieser Sparte der Umsatz mit Siemens wesentlich verringern wird.

Umsatzerlöse nach Regionen in Mio. €



Verlagerung von Umsatzerlösen von Deutschland in andere europäische Staaten.

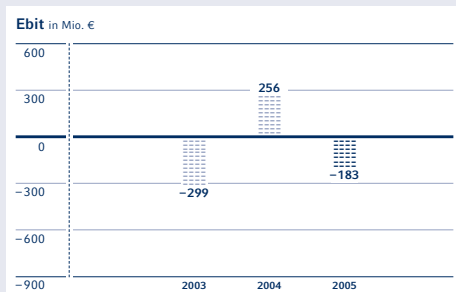
Umsatzerlöse nach Regionen

Geschäftsjahr zum 30. September	2003		2004		2005	
	in Mio. €	%	in Mio. €	%	in Mio. €	%
Deutschland	1.535	25	1.675	23	1.354	20
Übriges Europa	1.112	18	1.263	18	1.210	18
Nordamerika	1.393	23	1.524	21	1.504	22
Asien-Pazifik	1.821	29	2.263	32	2.223	33
Japan	256	4	364	5	332	5
Andere	35	1	106	1	136	2
Gesamt	6.152	100	7.195	100	6.759	100

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit)

Wir definieren Ebit als Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Das Management nutzt das Ebit als Kennzahl für Budget- und operative Zielvorgaben, um seine Geschäfte zu führen und den Geschäftserfolg zu beurteilen. Infineon berichtet Ebit-Daten, um Investoren aussagekräftige Informationen über den operativen Geschäftserfolg der Gesellschaft im Allgemeinen und über die einzelnen operativen Segmente im Besonderen zur Verfügung zu stellen. Das Ebit wird wie folgt aus den Konzern-Gewinn- und-Verlust-Rechnungen hergeleitet:

Geschäftsjahr zum 30. Sept. in Mio. €	2003	2004	2005
Konzernüberschuss/-fehlbetrag	-435	61	-312
Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	84	154	120
Zinsaufwendungen	52	41	9
Ebit	-299	256	-183



Preisdruck, schwacher US-Dollar/Euro-Wechselkurs und Sondereffekte beeinflussen das Ebit negativ.

Das Ebit verteilt sich wie folgt auf die Segmente¹:

Geschäftsjahr zum 30. Sept. in Mio. €	2003	2004	2005
Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket	148	252	134
Kommunikation	-213	-44	-295
Speicherprodukte	31	169	122
Sonstige Geschäftsbereiche	-50	-75	-4
Konzernfunktionen	-215	-46	-140
Gesamt	-299	256	-183

¹ Die Beträge der Vorjahre wurden an die aktuelle Darstellung angepasst.

Die Veränderung des Ebit ist das Resultat der unten aufgeführten Effekte innerhalb der Segmente:

--- Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

Die Ebit-Verbesserung im Geschäftsjahr 2004 resultierte hauptsächlich aus einem höheren Verkaufsvolumen und einer verbesserten Effizienz in der Produktion, teilweise kompensiert durch den anhaltenden Preisdruck. Der Ebit-Rückgang im Geschäftsjahr 2005 resultierte hauptsächlich aus dem geringeren Bruttoergebnis vom Umsatz. Das Ebit wurde negativ beeinflusst durch Kosten des Produktionstransfers im Zusammenhang mit dem geplanten Auslaufen der Produktion in München-Perlach sowie Kosten in Verbindung mit der neuen Produktionsstätte in Kulim, Malaysia.

--- Kommunikation

Der Ebit-Verlust verringerte sich im Geschäftsjahr 2004, hauptsächlich auf Grund geringerer Kosten des laufenden Geschäftsbetriebs, die aber teilweise durch Verluste aus der Akquisition von ADMtek aufgezehrt wurden. Das Ebit des Geschäftsjahrs 2004 enthält die Wertberichtigung auf den Geschäfts- und Firmenwert in Höhe von 71 Millionen Euro aus unserer Catamaran-Akquisition. Der höhere Ebit-Verlust im Geschäftsjahr 2005 resultierte hauptsächlich aus Kosten in Verbindung mit der Neuorganisation bestimmter Kommunikationsgeschäfte und Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 96 Millionen Euro sowie der Verringerung des Bruttoergebnisses vom Umsatz.

--- Speicherprodukte

Gründe für die Ebit-Verbesserung im Geschäftsjahr 2004 waren vorwiegend höhere Stückzahlen und die gestiegene Produktivität. Teilweise kompensiert wurde die Erhöhung von einem Rückgang der Lizenzeinnahmen, dem schwachen US-Dollar/Euro-Wechselkurs und von Aufwendungen im Zusammenhang mit kartellrechtlichen Ermittlungen. Der Ebit-Rückgang im Geschäftsjahr 2005 resultierte hauptsächlich aus einem Preisrückgang bei DRAM-Produkten und einem schwachen US-Dollar/Euro-Wechselkurs sowie gestiegenen F&E-Aufwendungen, die im Wesentlichen aus einer beschleunigten Technologieentwicklung und der Erweiterung unseres Produktportfolios resultieren. Diese Effekte konnten nicht vollständig durch Produktivitätsverbesserungen und gestiegene Lizenzeinnahmen kompensiert werden.

--- Sonstige Geschäftsbereiche

Der Ebit-Verlust in den Geschäftsjahren 2003 und 2004 spiegelt im Wesentlichen Wertberichtigungen auf Finanzanlagen wider. Zur Ebit-Verbesserung im Geschäftsjahr 2005 trug ein Erlös von 13 Millionen Euro aus der Veräußerung von Venture-Capital-Aktivitäten bei.

--- Konzernfunktionen

Der Ebit-Verlust verringerte sich im Geschäftsjahr 2004 im Wesentlichen durch geringere unverrechnete Leerkosten als Folge verbesserter Auslastung. Die Ebit-Verschlechterung im Geschäftsjahr 2005 resultierte hauptsächlich aus Restrukturierungskosten in Höhe von 78 Millionen Euro in Verbindung mit dem geplanten Auslaufen der Produktion in der Fertigungsstätte München-Perlach und der Restrukturierung unseres Glasfaserkomponentengeschäfts.

Zinsergebnis

Zinserträge erzielen wir hauptsächlich aus Zahlungsmitteln und Wertpapieren. Zinsaufwendungen entstehen uns hauptsächlich aus Bankdarlehen und Wandelanleihen, abzüglich aktivierter Zinsen für im Bau befindliche Fertigungsgebäude.

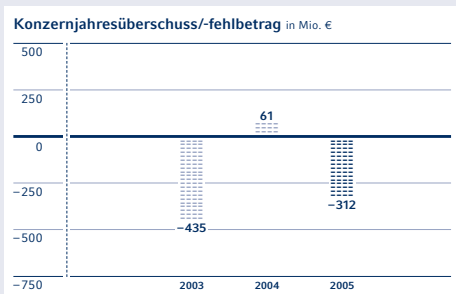
Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
Zinsergebnis in Mio. €	-52	-41	-9
Prozent des Umsatzes	-1%	-1%	0%

Zinsaufwendungen in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 hatten wir hauptsächlich aus unserer im Februar 2002 und der im Juni 2003 ausgegebenen Wandelanleihen. Zusätzlich beinhalten die Zinsaufwendungen im Geschäftsjahr 2004 angefallene Zinsen in Höhe von 21 Millionen Euro, die im Zusammenhang mit der Rückzahlung der rückgewährbaren Einlagen anderer Investoren an der Infineon Technologies SC300 GmbH & Co. OHG („SC300“), Dresden, gezahlt wurden. Diese Zinsaufwendungen wurden im Geschäftsjahr 2004 und 2005 teilweise durch den Rückkauf eines Teils unserer Wandelanleihen, durch gestiegene aktivierte Zinsen im Zusammenhang mit dem Bau von Fertigungsstätten und durch Zinserträge aus derivativen Finanzinstrumenten reduziert.

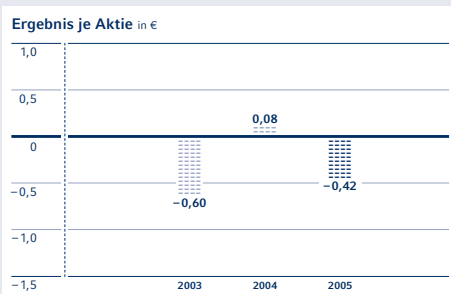
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und Ertrag in Mio. €	-84	-154	-120
Prozent des Umsatzes	-1%	-2%	-2%
Steuerquote	-24%	72%	-63%

Gemäß US-GAAP unterliegen aktive latente Steuern in Steuergewerbeten mit kumulativen Verlusten in den letzten drei Jahren einer Wertberichtigung, ohne dabei den Einfluss von erwarteten zukünftigen steuerpflichtigen Einkommen zu berücksichtigen. Im Geschäftsjahr 2003 wiesen wir eine Erhöhung der Wertberichtigung in Höhe von 182 Millionen Euro aus, die den realisierbaren Steuerertrag begrenzte. Wir erhöhten die Wertberichtigung infolge kumulativer Verluste in den letzten drei Jahren bis zum 30. September 2003 in bestimmten Steuergewerbeten. Trotzdem weisen wir im Geschäftsjahr 2003 Steuerertrag aus. Im Geschäftsjahr 2004 erhöhte sich unsere Steuerquote auf Grund von zusätzlichen Wertberichtigungen in Höhe von 54 Millionen Euro in Steuergewerbeten, die weiterhin kumulative Verluste in den letzten drei Jahren ausweisen, und höherer nicht abzugsfähiger Aufwendungen. Im Geschäftsjahr 2005, wie auch im Geschäftsjahr 2004, haben wir weiterhin einen kumulativen Verlust in den letzten drei Jahren in bestimmten Steuergewerbeten ausgewiesen und die Wertberichtigung in Höhe von 192 Millionen Euro erhöht, die den realisierbaren Steuerertrag begrenzte. Wir bewerten unsere latenten Steuern regelmäßig. Unsere Fähigkeiten zur Realisierung von Steuererträgen aus latenten Steuern hängen von der Möglichkeit ab, in Zukunft steuerliche Einkünfte zu erzielen und steuerliche Verlustvorträge sowie Steuervergünstigungen vor Eintritt der Verjährung zu nutzen. Wir erwarten, so lange keine Erträge für Steuern vom Einkommen und Ertrag in den besagten Steuergewerbeten auszuweisen, wie in diesen Steuergewerbeten über den Zeitraum der letzten drei Jahre ein kumulativer Verlust ausgewiesen wird.



Geringere Umsatzerlöse und Bruttomarge sowie Restrukturierungsaufwendungen führen zu einem Konzernjahresfehlbetrag.



Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag

Der Konzernjahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2003 verringerte sich deutlich, hauptsächlich als Folge des Umsatzwachstums, der gesteigerten Effizienz in der Fertigung und von Kostensenkungsprogrammen. Auf Grund der Fortführung dieses Trends erreichten wir im Geschäftsjahr 2004 wieder die Profitabilität. Die positive Entwicklung wurde durch Wertberichtigungen, Aufwendungen für kartellrechtliche Verfahren und Steueraufwendungen reduziert. Der Konzernjahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2005 ergab sich im Wesentlichen aus einer Kombination von geringeren Umsatzerlösen, eines geringeren Bruttoergebnisses vom Umsatz, Wertberichtigungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Restrukturierungsmaßnahmen und Steueraufwendungen.

DARSTELLUNG DER VERMÖGENSLAGE

Geschäftsjahr zum 30. Sept. in Mio. €	2004	2005	Veränderung in %
Umlaufvermögen	5.292	4.574	-14 %
Anlagevermögen	5.572	5.710	3 %
Summe Aktiva	10.864	10.284	-5 %
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.870	2.382	-17 %
Langfristige Verbindlichkeiten	2.016	2.273	13 %
Summe Verbindlichkeiten	4.886	4.655	-5 %
Summe Eigenkapital	5.978	5.629	-6 %

Zum 30. September 2005 ging das Gesamtvermögen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. Das Umlaufvermögen sank zum Ende des Geschäftsjahrs 2005 im Wesent-

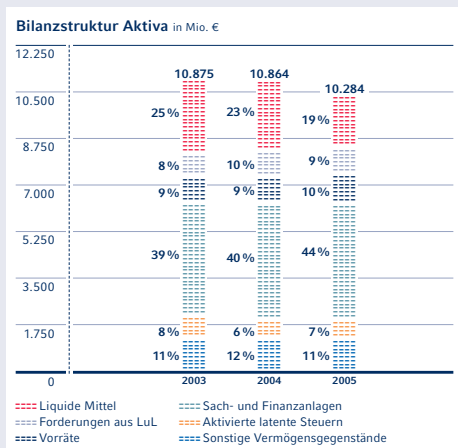
lichen auf Grund der Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 450 Millionen Euro, das im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden aufgenommen worden war.

Das Anlagevermögen stieg zum Ende des Geschäftsjahrs 2005 geringfügig an, da die Abschreibungen und Wertberichtigungen die Investitionen in Sachanlagen und Beteiligungen nahezu kompensierten.

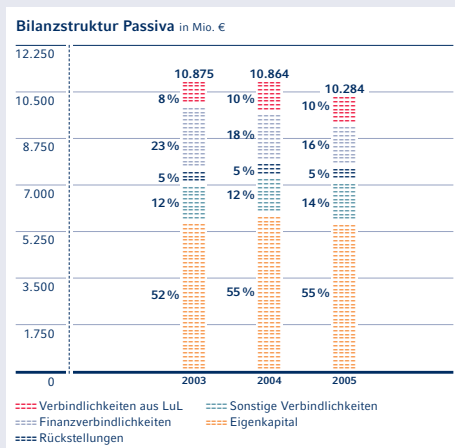
Die gesamten Verbindlichkeiten sanken zum Ende des Geschäftsjahrs 2005 im Wesentlichen auf Grund der Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 450 Millionen Euro, das im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden aufgenommen wurde. Gegenläufig dazu hat sich die Kreditaufnahme von langfristigen Darlehen in Höhe von 175 Millionen Euro ausgewirkt. Die Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten ergab sich im Wesentlichen auf Grund der Rückzahlung des Darlehens in Höhe von 450 Millionen Euro. Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich leicht auf Grund der Aufnahme von langfristigen Darlehen in Höhe von 175 Millionen Euro, die im Wesentlichen für die Finanzierung von F&E-Projekten und Fertigungsstätten in Portugal und Österreich bestimmt sind.

Im Geschäftsjahr 2005 reduzierte sich unser Eigenkapital im Wesentlichen durch den Konzernjahresfehlbetrag 2005. Die Eigenkapitalquote beträgt 55 Prozent zum 30. September 2005 (Vorjahr: 55 Prozent).

Im Geschäftsjahr 2005 betrug die Eigenkapitalrendite minus 5 Prozent, und die Gesamtkapitalrendite lag bei minus 3 Prozent gegenüber plus 1 Prozent im Geschäftsjahr 2004. Die Anlagendeckung sank auf Grund des Konzernjahresfehlbetrags sowie der Investitionen in Sachanlagen, die die planmäßigen Abschreibungen überstiegen, im Geschäftsjahr 2005 auf 150 Prozent im Ver-



Rückgang bei Liquide Mittel durch Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten.



Rückgang bei Finanzverbindlichkeiten durch Rückzahlung eines Darlehens.

gleich zu 167 Prozent im Vorjahr. Die Verringerung des Verschuldungsgrads auf 30 Prozent im Geschäftsjahr 2005 (Vorjahr: 33 Prozent) war im Wesentlichen bedingt

durch die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 450 Millionen Euro, das im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden stand.

DARSTELLUNG DER FINANZLAGE

Cash-Flow

Geschäftsjahr zum 30. September in Mio. €	2003	2004	2005
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von fortgeführten Geschäften	731	1.857	1.039
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.522	-1.809	-238
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Finanzierungstätigkeit	566	-402	-266
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit von aufgegebenem Geschäft	-1	-	-
Zahlungsmittel zum Ende des Geschäftsjahrs	969	608	1.148

Der Cash-Flow zeigt Herkunft und Verwendung der Geldströme in den Berichtsperioden. Ihm kommt damit eine zentrale Bedeutung für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft zu.

Die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit und die Mittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeit sind jeweils indirekt zahlungsbezogen ermittelt. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wird ausgehend vom Konzernjahresergebnis indirekt abgeleitet. Die Veränderungen von Bilanzpositionen sind um Effekte aus Währungsschwankungen und Konsolidierungskreisänderungen

bereinigt. Sie können deshalb nicht mit den entsprechenden Veränderungen in den Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2005 ergibt sich im Wesentlichen aus dem Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von 312 Millionen Euro, Abschreibungen in Höhe von 1.316 Millionen Euro, Wertberichtigungen in Höhe von 134 Millionen Euro und latenten Steuern in Höhe von 88 Millionen Euro. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wurde durch den Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und

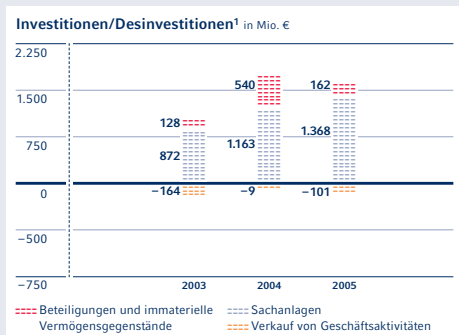
Leistungen in Höhe von 119 Millionen Euro positiv beeinflusst. Diese Effekte wurden teilweise aufgehoben durch die Verringerung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 166 Millionen Euro.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2005 resultiert überwiegend aus Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 1.368 Millionen Euro, im Wesentlichen zum Ausbau unserer Fertigungsstätten in Dresden und Richmond, Investitionen in Höhe von 135 Millionen Euro in assoziierte Unternehmen, wie Inotera, der Netto-Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von 1.082 Millionen Euro sowie den Einzahlungen in Höhe von 101 Millionen Euro aus der Veräußerung von Geschäften.

Im Geschäftsjahr 2005 bestand der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit im Wesentlichen aus der Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 450 Millionen Euro, das im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden aufgenommen worden war.

Liquidität unter Berücksichtigung von Investitionen zeigt. Das bedeutet nicht, dass der restliche verfügbare Cash-Flow für sonstige Ausgaben verwendet werden kann, da Schuldendienstverpflichtungen oder andere feste Ausgaben noch nicht abgezogen sind. Der Free-Cash-Flow wird wie folgt aus den Konzern-Kapitalflussrechnungen hergeleitet:

Geschäftsjahr zum 30. Sept. in Mio. €	2003	2004	2005
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit aller Geschäfte	730	1.857	1.039
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.522	-1.809	-238
Kauf/Verkauf von Wertpapieren, Saldo	739	158	-1.082
Free-Cash-Flow	-53	206	-281

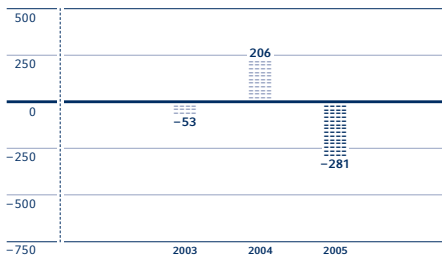


Investitionen in Sachanlagen und Beteiligungen dienen der Verbesserung der Produktionsprozesse und dem Ausbau der Fertigungskapazitäten.
1 Ohne Wertpapiere.

Free-Cash-Flow

Wir definieren den Free-Cash-Flow als Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit, bereinigt um den Kauf und Verkauf von kurzfristig verfügbaren Wertpapieren. Da wir einen Großteil unserer liquiden Mittel in Form von kurzfristig verfügbaren Wertpapieren halten und in einer kapitalintensiven Industrie tätig sind, berichten wir den Free-Cash-Flow. Damit wollen wir den Investoren eine Kennzahl zur Verfügung stellen, die die Veränderung der

Free-Cash-Flow in Mio. €



Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit können die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit, bereinigt um die Erlöse aus dem Verkauf von kurzfristigen Wertpapieren, nicht ausgleichen.

Investitionen

Geschäftsjahr zum 30. Sept. in Mio. €	2003	2004	2005
Speicherprodukte	576	716	921
Logik-Produkte	296	447	447
Gesamt	872	1.163	1.368

Abhängig von der Geschäftssituation erwarten wir, im Geschäftsjahr 2006 zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Euro in Sachanlagen zu investieren, größtenteils in unsere Fertigungsstätten in Richmond/Virginia, USA und Kulim, Malaysia. Wir werden auch fortlaufend die Produktivität in unseren Fertigungsstätten verbessern und

die Technologie, vor allem in Dresden, weiterentwickeln. Zum 30. September 2005 waren davon ungefähr 650 Millionen Euro fest vereinbart; sie sind in den unbedingten Abnahmeverpflichtungen enthalten. Auf Grund der Länge des Zeitraums zwischen der Bestellung und der Lieferung von Anlagen sind üblicherweise erhebliche Investitionsbeträge vorab festgelegt. Etwa 50 Prozent der erwarteten Investitionen sollen auf die Front-End- und die Back-End-Fabriken des Segments Speicherprodukte entfallen.

MITARBEITER UND CAMPEON

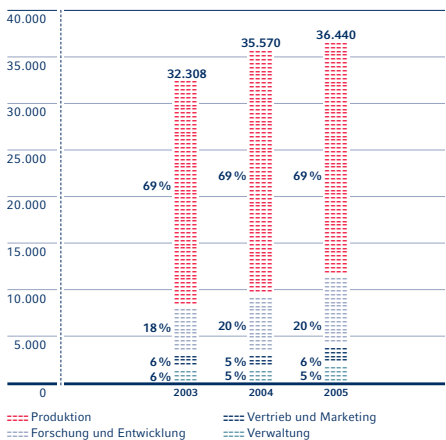
Mitarbeiter

Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung unserer Belegschaft nach Regionen und Funktionen jeweils zum 30. September der genannten Geschäftsjahre.

Zum 30. September	2003	2004	2005
Funktionen:			
Produktion	22.405	24.540	25.114
Forschung und Entwicklung	5.935	7.160	7.401
Vertrieb und Marketing	2.048	1.948	2.016
Verwaltung	1.920	1.922	1.909
Gesamt	32.308	35.570	36.440
Regionen:			
Deutschland	16.166	16.387	16.119
Übriges Europa	5.034	5.631	5.482
Nordamerika	2.757	2.982	3.193
Asien-Pazifik	8.116	10.340	11.451
Japan	118	133	158
Andere	117	97	37
Gesamt	32.308	35.570	36.440

Im Geschäftsjahr 2004 waren vorwiegend die Erweiterungen der Fertigungskapazitäten in Deutschland, Malaysia und China für die Einstellung weiterer Mitarbeiter ausschlaggebend. Im Geschäftsjahr 2005 setzte sich dieser Trend in Malaysia und China fort.

Mitarbeiter in den Bereichen¹



Weiterhin hoher Mitarbeiterereinsatz zu Gunsten von Forschung und Entwicklung. 1 Rundungsdifferenzen sind möglich.

Campeon

Wir haben einen langfristigen Leasingvertrag mit der MoTo Objekt Campeon GmbH & Co. KG („MoTo“) über einen Bürokomplex im Süden Münchens abgeschlossen, der von MoTo errichtet worden ist. Dieser Bürokomplex, genannt Campeon, ermöglicht uns, die meisten Mitarbeiter, die derzeit über verschiedene Standorte im Raum München verteilt sind, in einer zentralen Arbeitsumgebung zusammenzuführen. MoTo war für den Bau verantwortlich, der in der zweiten Hälfte des Kalenderjahrs 2005 fertig gestellt worden ist. Wir haben keine Finanzierungsverpflichtung für MoTo und keine Garantien im Zusammenhang mit der Errichtung übernommen. Wir haben das Leasingobjekt im Oktober 2005 übernommen und mit dem stufenweisen Umzug unserer Mitarbeiter zum neuen Standort begonnen.

WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Im November 2005 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft dem Vorhaben zugestimmt, Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Segments Speicherprodukte an eine eigenständige und vollständig von Infineon gehaltene Tochtergesellschaft zu übertragen (gemäß deutschem Recht ist diese Übertragung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten oder einem Teilbetrieb als Ausgliederung bekannt).

AUSBLICK

Branchenexperten prognostizieren für den weltweiten Halbleitermarkt ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich im Kalenderjahr 2006. Für das Geschäftsjahr 2006 erwarten wir mindestens eine Geschäftsentwicklung, die diesen Trend widerspiegelt. Im Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket gehen wir von einem weiteren Wachstum durch die zunehmende Nachfrage nach Elektronik in Fahrzeugen, Spannungswandlern und energiesparenden Technologien aus. Darüber hinaus erwarten wir im Segment Kommunikation eine positive Geschäftsentwicklung im Wesentlichen wegen unserer leistungsfähigen Hochfrequenztechnologien. Im Segment Speicherprodukte werden wir unser Portfolio weiter auf Produkte mit höheren Margen konzentrieren.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 erwarten wir im Vergleich zum vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 leicht steigende Umsätze. Wir werden den Auslauf der Produktion in München-Perlach, den Aufbau des neuen Produktionsstandorts in Kulim, Malaysia, sowie den Ausbau der 300-Millimeter-Produktion in Richmond fortführen. Zusätzlich werden wir ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen in unserem Konzernergebnis ausweisen.

Im November 2005 hat unser Aufsichtsrat Pläne zur Ausgliederung des Segments Speicherprodukte und zur Gründung einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Infineon zum 1. Juli 2006 genehmigt. Für unser Management ist anschließend ein Börsengang dieser Gesellschaft die gegenwärtig bevorzugte Lösung.

Ausblick für unsere Segmente für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2006:

--- Im Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket gehen wir davon aus, dass Umsatz und Ebit im Bereich Automobil- und Industrieelektronik im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 gegenüber dem vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 leicht steigen werden, auch wenn jährliche Preissenkungen bei großen Kunden sich erstmals im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 auswirken werden. Im Geschäft mit Sicherheits- und Chipkarten-ICs erwarten wir, dass Umsatz und Ebit weiter unter Druck bleiben werden. Wir gehen jedoch derzeit davon aus, dass dieser Trend auf Grund der begonnenen Kostensenkungsmaßnahmen ab dem zweiten Geschäftsjahrsquartal 2006 umgekehrt wird. Insgesamt erwarten wir für das Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket im Vergleich zum vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 einen leichten Umsatzanstieg und ein stabiles Ebit. Berücksichtigt sind dabei bereits die

Auswirkungen der erwähnten Preissenkungen, Aufwendungen für das planmäßige Auslaufen der Produktion in München-Perlach und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Produktionsstätte in Kulim, Malaysia.

--- Für das Segment Kommunikation gehen wir davon aus, dass der Umsatz im Segment Kommunikation im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 im Vergleich zum vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 stabil bleiben wird. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 erwarten wir für dieses Segment ein negatives Ebit in der Größenordnung des Vorquartals.

--- Im Segment Speicherprodukte wird unserer Ansicht nach im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 die saisonal bedingt hohe Nachfrage nach Computern das Bit-Wachstum im DRAM-Markt fördern. Auf der Angebotsseite zeichnet sich ein Wachstum von Kapazitäten und Produktivitäten in der Branche ab, was nur teilweise durch Verlagerung von Kapazitäten einiger Wettbewerber zu Non-DRAM-Produkten ausgeglichen wird. Diese Entwicklung sowie der Preisdruck und die Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit von Chipsätzen im PC-Segment erschweren eine Prognose der Preisentwicklung. Wir gehen davon aus, dass unsere Bit-Produktion auf Grund der zusätzlichen Kapazitäten unseres Joint Ventures Inotera und unserer 300-Millimeter-Produktionsanlage in Richmond weiter steigt. Wir werden unser Portfolio auch weiterhin auf Wachstumsbereiche mit höheren Margen konzentrieren, darunter Infrastruktur, High-End-Grafikchips sowie Consumer- und mobile Applikationen.

Konzernfinanzdaten

Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre in Mio. €

	2003	2004	2005
Umsatzerlöse			
aus Lieferungen und Leistungen an Dritte	5.153	6.169	5.843
aus Lieferungen und Leistungen an verbundene Unternehmen	999	1.026	916
Umsatzerlöse gesamt	6.152	7.195	6.759
Umsatzkosten	4.614	4.670	4.909
Bruttoergebnis vom Umsatz	1.538	2.525	1.850
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.089	1.219	1.293
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	679	718	655
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	29	17	78
Sonstige betriebliche Aufwendungen, Saldo	85	257	92
Betriebsergebnis	-344	314	-268
Zinsergebnis	-52	-41	-9
Anteiliger Überschuss/Fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	18	-14	57
Erträge/Aufwendungen aus der Realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen	-2	2	-
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo	21	-64	26
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	8	18	2
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-351	215	-192
Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-84	-154	-120
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	-435	61	-312
Konzernüberschuss/-fehlbetrag pro Aktie – verwässert und unverwässert in €	-0,60	0,08	-0,42

Konzern-Bilanzen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre in Mio. €

	2004	2005
Aktiva		
Umlaufvermögen:		
Zahlungsmittel	608	1.148
Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.938	858
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.056	952
Vorräte	960	1.022
Aktive kurzfristige latente Steuern	140	125
Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	590	469
Summe Umlaufvermögen	5.292	4.574
Sachanlagen	3.587	3.751
Finanzanlagen	708	779
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel	109	88
Aktive latente Steuern	541	550
Sonstige Vermögensgegenstände	627	542
Summe Aktiva	10.864	10.284
Passiva		
Kurzfristige Verbindlichkeiten:		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristig fällige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten	571	99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.098	1.069
Rückstellungen	555	497
Passive kurzfristige latente Steuern	16	17
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	630	700
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	2.870	2.382
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristig fällige Bestandteile	1.427	1.566
Passive latente Steuern	21	65
Sonstige Verbindlichkeiten	568	642
Summe Verbindlichkeiten	4.886	4.655
Eigenkapital:		
Grundkapital	1.495	1.495
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5.800	5.800
Verlustvortrag	-1.200	-1.512
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-117	-154
Summe Eigenkapital	5.978	5.629
Summe Passiva	10.864	10.284

Konzern-Eigenkapital-Veränderungsrechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre in Mio. €

	Ausgegebene Stückaktien Anzahl	Ausgegebene Stückaktien Betrag Mio. €
Konzernbilanz zum 1. Oktober 2002	720.784.218	1.442
Konzernjahresfehlbetrag	–	–
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	–	–
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	–	–
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:		
Kauf von Catamaran	96.386	–
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo	–	–
Andere Einlagen	–	–
Konzernbilanz zum 30. September 2003	720.880.604	1.442
Konzernjahresüberschuss	–	–
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	–	–
Konzernjahresüberschuss unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	–	–
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:		
Rückzahlung rückgewährbarer Einlagen	26.679.255	53
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo	–	–
Konzernbilanz zum 30. September 2004	747.559.859	1.495
Konzernjahresfehlbetrag	–	–
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	–	–
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	–	–
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:		
Ausübung von Aktienoptionen	9.500	–
Konzernbilanz zum 30. September 2005	747.569.359	1.495

Zusätzlich eingezahltes Kapital Mio. €	Verlustvortrag Mio. €	Kumulierte Fremdwährungsum- rechnungsdifferenzen Mio. €	Zusätzliche Pensionsver- bindlichkeiten Mio. €	Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren Mio. €	Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Sicherungsgeschäften Mio. €	Gesamt Mio. €
5.569	- 826	- 5	- 20	- 2	-	6.158
-	- 435	-	-	-	-	- 435
-	-	- 76	2	13	-	- 61
						- 496
1	-	-	-	-	-	1
7	-	-	-	-	-	7
- 4	-	-	-	-	-	- 4
5.573	- 1.261	- 81	- 18	11	-	5.666
-	61	-	-	-	-	61
-	-	- 41	18	- 7	1	- 29
						32
225	-	-	-	-	-	278
2	-	-	-	-	-	2
5.800	- 1.200	- 122	-	4	1	5.978
-	- 312	-	-	-	-	- 312
-	-	64	- 84	8	- 25	- 37
						- 349
-	-	-	-	-	-	-
5.800	- 1.512	- 58	- 84	12	- 24	5.629

Konzern-Kapitalflussrechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre in Mio. €

	2003	2004	2005
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	-435	61	-312
Anpassungen zur Überleitung des Konzernjahresüberschusses/-fehlbetrags auf Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Planmäßige Abschreibungen	1.437	1.320	1.316
Erworbene, nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte	6	9	-
Auflösung der Abgrenzung von Personalaufwendungen	7	2	-
Wertberichtigungen auf Forderungen	-16	15	3
Gewinn aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-56	-9	-8
Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Geschäftsaktivitäten	10	2	-39
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	3	-5	-8
Anteiliger Überschuss/Fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	-18	14	-57
Aufwendungen/Erträge aus der Realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen	2	-2	-
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	-8	-18	-2
Außerplanmäßige Abschreibungen	98	136	134
Latente Steuern	16	96	88
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens:			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-227	-219	119
Vorräte	-112	-40	-25
Sonstige Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	156	154	-2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-217	228	-52
Rückstellungen	164	92	-114
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-17	-22	-
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten	-62	43	-2
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	731	1.857	1.039

Konzern-Kapitalflussrechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre in Mio. €

	2003	2004	2005
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit:			
Auszahlungen für Wertpapiere des Umlaufvermögens	-2.752	-2.678	-2.228
Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.013	2.520	3.310
Einzahlungen aus dem Abgang von Geschäftsanteilen	164	9	101
Einzahlungen/Auszahlungen für Beteiligungen, abzüglich erworbene Zahlungsmittel	6	-29	-
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an assoziierten und verbundenen Unternehmen	-76	-386	-135
Dividende von den nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	-	-	51
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-58	-125	-27
Auszahlungen für Sachanlagen	-872	-1.163	-1.368
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	53	43	58
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.522	-1.809	-238
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit:			
Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten	-36	62	-20
Veränderung der Finanzforderungen und -verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen	-76	75	18
Erhöhung langfristiger Verbindlichkeiten	700	-	192
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	-25	-549	-500
Veränderung der als Sicherheitsleistungen hinterlegten liquiden Mittel	3	-43	21
Einzahlungen aus Ausgabe von Aktien an Minderheitsgesellschafter	-	53	23
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	566	-402	-266
Währungsumrechnungseffekte auf Zahlungsmittel	-4	-7	5
Veränderung der Zahlungsmittel	-229	-361	540
Veränderung der Zahlungsmittel von aufgegebenem Geschäft	-1	-	-
Zahlungsmittel am Geschäftsjahresanfang	1.199	969	608
Zahlungsmittel am Geschäftsjahresende	969	608	1.148

Finanzkalender

Wichtige Finanztermine 2006*

... **Dienstag, 24. Januar:**

Veröffentlichung des Berichts über das 1. Quartal 2006

... **Donnerstag, 16. Februar, 10.00 Uhr:**

Hauptversammlung 2006 in München, ICM (Internationales Congress Center München)

... **Mittwoch, 26. April:**

Veröffentlichung des Berichts über das 2. Quartal 2006

*Vorläufig.

Zukunftsorientierte Aussagen:

Der Kurzbericht enthält zukunftsorientierte Aussagen. Diese sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der Infineon Technologies AG. Diese beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen auf Grund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

Basisinformationen zur Aktie

Art der Aktien	Namensaktien (Stammaktien) in Form von Aktien oder American Depositary Shares (ADS) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 2,00 € (Verhältnis ADS:Aktien = 1:1)
Grundkapital	€1.495 Mio. (am 30.9.2005)
Ausstehende Aktien	748 Mio. (am 30.9.2005)
Börsennotierungen	Aktien: Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) ADS: New York Stock Exchange (NYSE)
Optionshandel	Optionen auf die Aktien: Eurex Optionen auf die ADS: CBOE
Börsengang	13. März 2000 an der FWB und NYSE
Emissionspreis	€35,00 pro Aktie US-\$33,92 pro ADS
Börsenkürzel	IFX
ISIN-Code	DE0006231004
CUSIP	45662N103
Bloomberg	IFX.GY (Xetra-Handelssystem) IFX.US
Reuters	IFXGn.DE
Indexmitglied (Auswahl)	Dax-30 Dow-Jones-German-Titans-30 Dow Jones Stoxx Semiconductor FTSE-Euro-100 MSCI Germany SOX S&P-Europe-350

Impressum

Herausgeber: Infineon Technologies AG, München
Redaktion: Investor Relations, Corporate Communications, Accounting & Financial Reporting
Redaktionsschluss: 30. November 2005
Geschäftsjahr: 1. Oktober bis 30. September
Abschlussprüfer: KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin und Frankfurt am Main
Gestaltung: häfelinger + wagner design, München
Fotonachweis: Andreas Pohlmann
Druck: Kunst- und Werbedruck GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen

Bestell-Nr. B192-H8089-G3

Gedruckt in Deutschland.

Die folgenden Bezeichnungen sind **Marken und/oder Markennamen** der Infineon Technologies AG: Infineon, das Infineon-Logo, das AENEON-Logo, FCOS, COOLMOS, OptiMOS, SMARTi, TRICORE und VINAX sind eingetragene Marken von Infineon Technologies AG. E-GOLDLite, E-GOLDradio, GEMINAX Pro, MicroSlim, MobileRAM, MP1-G, MultiMediaCard und S-Gold2 sind Marken und/oder Markennamen der Infineon Technologies AG. CellularRAM ist eine Marke von Micron Technologies, Inc. innerhalb der USA und von Infineon Technologies AG außerhalb der USA und wird sowohl von Micron als auch Infineon in Lizenz verwendet.

Das **Bluetooth**-Markenzeichen wird von Infineon in Lizenz verwendet.

Alle anderen in diesem Kurzbericht verwendeten Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte die Rechte ihrer Inhaber verletzen kann.

Infineon Technologies

Wenn Sie den Geschäftsbericht 2005 in deutscher oder englischer Sprache bestellen oder wenn Sie diese Berichte und aktuelle Anlegerinformationen online lesen möchten, besuchen Sie uns im Internet unter **www.infineon.com/boerse**. Aktionäre und andere interessierte Anleger können kostenlose Einzelexemplare telefonisch oder schriftlich bei der Abteilung Investor Relations anfordern.

Hauptverwaltung: Am Campeon 1–12, 85579 Neubiberg/München, Tel. +49 (0)89 234-0

Kontakt für Anleger und Analysten:

Investor.Relations@infineon.com, Tel. +49 (0)89 234-26655, Fax +49 (0)89 234-26155

Kontakt für Journalisten:

Media.Relations@infineon.com, Tel. +49 (0)89 234-28480, Fax +49 (0)89 234-28482

Besuchen Sie uns im Internet: www.infineon.com



Never stop thinking